



國立臺灣大學管理學院商學研究所

碩士論文

Graduate Institute of Business Administration

College of Management

National Taiwan University

Master's Thesis

ESG-S 社會構面員工相關指標揭露之比較研究：

以台灣半導體製造業上市公司為例

Employee-Related Indicators in the Social (S) Dimension
of ESG Reports: A Comparative Study of Listed
Semiconductor Manufacturing Firms in Taiwan

林恬爾

Tien-Er Lin

指導教授：劉念琪 博士

Advisor: Nien-Chi Liu Ph.D.

中華民國 115 年 6 月

June, 2026

謝辭

研究所這兩年的求學歷程充滿挑戰，也讓我獲得許多寶貴的學習與成長。在論文完成之際，謹向一路上給予我指導、協助與陪伴的師長、家人與朋友表達最誠摯的感謝。

首先，我要衷心感謝我的指導教授——劉念琪教授。在研究過程中教授不僅於研究主題、架構建構與分析方法上給予細心指導，更在我遇到瓶頸時提供方向與鼓勵，使我在撰寫論文的過程中獲益良多，也讓我學習到如何以更完整與周延的角度思考研究問題；我也要感謝陳怡靜與戴曉惠兩位口試委員撥冗審閱本論文，並於口試過程中提供許多寶貴的建議與指教；另外，還要特別感謝明哲學長與華羚學姐在論文撰寫期間協助我應對各種問題，並分享資料整理經驗，給予了我許多實質上的幫助。

最後，感謝一路陪伴我的家人、皮皮、男朋友與朋友們。謝謝家人始終給予我最大的支持，讓我能夠無後顧之憂地投入研究與學習；謝謝皮皮，雖然它可能不懂什麼是論文也不懂畢業是什麼，但它總是那麼可愛給我許多力量幫我充電；謝謝男朋友每天聽我分享生活讓我能夠在繁忙的每一天中喘口氣；也感謝身邊的朋友們，在課業、求職以及生活的各個階段給予我鼓勵與陪伴。無論是一起討論課業、分享煩惱，或是在壓力大的時候提供放鬆與歡笑，都是我在忙碌的研究生生活中最快樂的一段時光。

論文的完成也代表我即將迎接人生新的挑戰，作為學生的最後兩年我過得很充實且開心。感謝這段旅程中所有相遇與陪伴，願自己能過帶著這段時間的收穫，勇敢迎向下一段旅程。

中文摘要



近年來，隨著永續發展理念普及與 ESG（Environmental, Social, Governance）資訊揭露要求日益提高，企業社會責任與永續經營已成為企業治理的重要議題。相較於環境（E）與治理（G）構面已逐漸形成較為標準化之揭露架構，社會（S）構面涵蓋勞動權益、人才培育、職業安全及供應鏈管理等多元議題，企業於揭露內容與呈現方式上仍具有較高彈性，因而呈現較大的差異性。

本研究以台灣半導體製造業上市公司為研究對象，選取 20 家企業於 2024 年發布之永續報告書作為分析文本，並採用內容分析法進行系統性比較。透過建立半導體產業社會構面之分類架構，以及從揭露架構、揭露廣度及揭露深度等三個面向進行分析，探討台灣半導體產業 S 構面揭露之共通性與差異性，以進一步檢視公司規模及供應鏈位置對揭露內容之影響。

研究結果顯示，半導體產業在部分具高度量化特性之議題上已逐漸形成共通揭露模式。然而，多數社會議題仍存在顯著差異，顯示產業整體尚未形成高度一致之揭露標準。其次，公司規模與揭露程度呈現正向關係，大型企業通常具有較高之揭露廣度與深度，但規模並非唯一影響因素，企業治理成熟度與永續管理能力亦可能影響揭露表現。最後，產業鏈位置對揭露重點具有一定影響，製造企業傾向採取較制度化且全面性之揭露方式，而封裝企業則較聚焦於人力資源等勞動相關議題。

本研究有助於釐清台灣半導體產業社會構面揭露之現況與特徵，並補充產業層級 ESG 社會構面比較研究之不足。研究結果可作為企業未來優化永續資訊揭露、提升資訊透明度及建立產業揭露共識之參考依據。

關鍵字：ESG、人力資源永續、社會構面、永續報告書、資訊揭露、半導體產業、內容分析法

Abstract



This study examines Social (S) disclosures in the sustainability reports of listed semiconductor companies in Taiwan. While Environmental (E) and Governance (G) disclosures have become increasingly standardized, Social (S) disclosures remain diverse due to the broad range of issues they encompass, including labor rights, human rights, employee development, and occupational health and safety.

Using content analysis, this study analyzes the 2024 sustainability reports of 20 Taiwanese semiconductor companies. A classification framework was developed to compare disclosure structure, breadth, and depth, with particular attention to the effects of company size and value-chain position.

The results show that certain topics, such as workforce demographics, employee training, and occupational safety, have gradually formed common disclosure practices across the industry. However, significant differences remain in many social-related topics, indicating a lack of overall standardization. Larger companies generally demonstrate broader and deeper disclosures, although governance maturity and sustainability management capabilities also influence disclosure performance. In addition, value-chain position affects disclosure priorities: manufacturing firms tend to provide more comprehensive and systematic disclosures, whereas packaging firms place greater emphasis on labor issues.

The findings contribute to a better understanding of Social (S) disclosure practices in Taiwan's semiconductor industry and provide insights for improving sustainability reporting quality and transparency.

Keywords: ESG, Social Disclosure, Sustainability Report, Semiconductor Industry, Content Analysis

目次



謝辭	i
中文摘要	ii
Abstract.....	iii
目次	iv
圖次	v
表次	vi
第一章、緒論	1
第一節、研究背景與動機	1
第二節、研究問題與研究目的	5
第二章、文獻回顧	6
第一節、ESG 架構的社會（S）構面之內涵與演進	6
第二節、ESG 資訊揭露之現況與準則	7
第三節、ESG 社會構面揭露之實務與研究現況	10
第四節、供應鏈治理下社會（S）構面之重要性	12
第三章、研究方法	14
第一節、研究架構	14
第二節、研究對象與資料來源	15
第三節、內容分析法	19
第四章、研究結果	23
第一節、分類架構之建構結果	23
第二節、變數分析之結果	41
第五章、結論與建議	56
第一節、研究發現	56
第二節、研究問題回應	60
第三節、研究限制與未來研究建議	63
參考文獻	66
附錄	72

圖次

圖一、半導體產業鏈概況	17
圖二、內容分析流程圖	19
圖三、樣本企業揭露深度分布（依產業鏈）	46
圖四、樣本企業揭露深度分布（依企業規模）	46
圖五、樣本企業揭露廣度分布（依產業鏈）	51
圖六、樣本企業揭露廣度分布（依企業規模）	51

表次

表一、研究分析架構矩陣	15
表二、樣本概述	18
表三、樣本公司報告書章節與分類主題對照表	24
表四、樣本公司報告書分層類別與標準化揭露指標	27
表五、揭露深度分析結果彙整表	44
表六、揭露廣度分析結果彙整表	50
表七、樣本企業揭露深廣度差異比較表	53
表八、子類別揭露缺口摘要表	54
表九、子類別揭露深度差距摘要表	55
表十、典範指標摘要表	57



第一章、緒論

第一節、研究背景與動機

近年來，隨著聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）之推動以及全球永續意識提升，企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）之內涵已不僅僅在於單純強調道德義務與公益形象，而是逐步轉為以環境（Environmental）、社會（Social）與公司治理（Governance）為核心之 ESG 架構。傳統 CSR 著重的是企業自願性的承諾，相較之下，ESG 更強調其與企業財務風險與長期價值之間的關聯性，使永續議題成為資本市場去評價企業表現的關鍵因素之一。

在此制度的演進過程中，聯合國於 2006 年所提出的責任投資原則（Principles for Responsible Investment, UN PRI）可視為標示責任投資理念制度化之重要里程碑。PRI 共有六大原則（Principles for Responsible Investment, n.d.），包含將 ESG 納入投資分析（Incorporation）、積極行使股東權利（Active Ownership）、要求適當資訊揭露（Appropriate Disclosure）、促進產業採納（Promote Acceptance）、加強合作（Work Together）以及揭露自身實踐情形（Report Activities）。這些原則的出現不僅界定了責任投資之基本行為準則，使得全球資本市場逐步將環境、社會與公司治理等三大因素納入投資決策框架之中，更促使投資機構將 ESG 議題納入決策流程與組織治理架構，成為投資決策的制度性規範。

在六大原則之中，第三項原則 Appropriate Disclosure 強調投資機構應要求被投資企業提供適當之 ESG 資訊揭露，進而顯示 ESG 已由自願性的資訊揭露，轉變為受到資本市場監督與要求之揭露體系。此一機制因此使企業 ESG 資訊由「自願性的形象管理工具」轉為「投資決策之所需資訊」，進一步促成了揭露標準之制度化與規範化。而隨著 PRI 簽署機構數量持續增加，責任投資理念更是逐漸成為國際金融市場主流，使得企業若欲取得資金與維持投資人信任，便需要

回應相關揭露要求。因此，ESG 揭露體系之發展，可視為由資本市場內生驅動之制度演進結果。



根據 KPMG 全球企業永續大調查（KPMG，2024）的結果顯示，全球前 250 大公司中有超過 96% 的企業透過定期發布企業永續報告書揭露資訊，而台灣前百大公司撰寫率亦高達 99%（較 2022 年提高 5%），顯示尤其是在大型以及上市櫃企業中，ESG 報告書的撰寫已成為主流趨勢。自 2025 年起，台灣金融監督管理委員會亦一改過去資本額 20 億元以下公司得免編製永續報告書之規定，強制全國上市櫃公司均應申報 ESG 永續報告書（金融監督管理委員會，2025）。顯示企業永續資訊揭露已由過去公司以自願性為主之倡議行為，逐步轉型為具監理要求之規範，並成為資本市場評估企業風險與永續能力之基本資訊基礎。

在全球永續轉型的浪潮中，企業所面臨的揭露壓力已不限於單一組織內部的合規，更延伸至整條供應鏈的協同管理。隨著國際大廠紛紛承諾淨零排放目標，供應鏈的穩定性與透明度已從傳統的「成本與效率」導向，轉向以「韌性與永續」為核心。在這種高度依存的供應鏈架構下，上游供應商的 ESG 績效直接影響下游品牌的碳足跡表現與社會責任評級，形成了強大的傳遞效應。

在此由資本市場驅動之制度環境下，不同產業所承受之 ESG 揭露壓力程度並不一致。特別是資本密集度高、國際供應鏈高度整合，且與全球科技產業緊密連動之產業，其永續資訊揭露往往會成為投資人與跨國客戶評估風險與合作關係之重要依據。另外，對於位處供應鏈中上游、具備高影響力的關鍵零組件製造商而言，來自品牌端的綠色採購要求（如 Renewable Energy 100、Science Based Targets initiative）更是已轉化為具體的商務合約條款。這使得永續報告書不再僅是財務資訊的補充，而是企業在複雜供應鏈中維持競爭優勢、確保獲取國際訂單的必要通行證。因此，該類產業在 ESG 制度化浪潮中，通常承受較為顯著之揭露要求與市場監督。其中，作為全球第四大貿易商品，半導體製造業正屬於此類高度全球化且資本密集之核心產業。

台灣半導體產業長期為國家經濟發展之重要支柱，無論在產值規模、出口占比或全球市占率方面，均具有關鍵戰略地位。尤其是在晶圓代工製造與先進製程領域，台灣便製造全球超過 60% 的晶片，一直保持著全球第一的領先地位，於全球供應鏈中扮演著不可替代之角色，也因而使該產業成為國際投資人與跨國品牌企業高度關注之對象。

在此高度全球化與資本市場關注之情境下，半導體企業之 ESG 資訊揭露理應具有相對成熟之制度化架構。另一方面，隨著全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）、永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）以及氣候相關財務揭露工作小組（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）等國際揭露框架之發展，企業永續資訊揭露也已朝向標準化與可比較化方向演進。其後，國際永續準則理事會（ISSB）所發布之 IFRS S1 與 S2 更進一步整合並強化了 TCFD 相關架構，建立具權威性且可由各國採納為強制揭露之標準。

然而，揭露標準之建立並不必然代表市場對 ESG 表現之評價已趨一致。Billio 等人（2021）的研究指出，不同 ESG 評級機構由於使用不同指標、對議題定義相異以及權重配置不同等原因，使其評分結果存在顯著差異，顯示 ESG 指標選擇與衡量方式尚未達成高度統一之共識，且此種評級差異也反映了 ESG 構面界定與衡量方法之多元性。Hess（2019）之研究也說明，由於企業對於揭露內容具有高自主性，因此即使圍繞相同議題也可能產生高異質性的結果，使 ESG 作為制度性監督機制之實際功能被削弱。而進一步觀察企業永續報告書內容亦可發現，ESG 三大面向之揭露成熟度與結構一致性並不完全相同，尤其在涵蓋議題範圍較廣且部分內容涉及質性判斷之社會（S）構面，其揭露與評價方式往往呈現出更高程度之差異性與彈性（Waas，2021）。

在環境（E）面向方面，GRI 與 TCFD 對溫室氣體排放、能源使用、碳管理與氣候風險揭露皆訂有相對明確之指標與建議架構。在氣候相關財務揭露上，各國監理機構（如 ISSB）亦逐步將碳盤查與氣候風險揭露納入強制或準強制規範，使相關資訊在衡量方法與揭露格式上具較高的透明度與一致性。而在公司治理

(G) 面向，也多遵循 GRI 與 SASB 等準則，內容通常涉及董事會結構、獨立董事比例、內部控制與風險管理機制等制度設計，多數國家亦建立相關監理法規與上市櫃治理準則，使揭露項目具相對固定之框架。

相較之下，社會 (S) 面向涵蓋範圍包括勞動安全、員工培育、供應鏈管理、人權保障與社區參與等多元議題。雖然 GRI 與 SASB 亦提供相關揭露建議，但其議題範圍廣泛，且部分內容涉及質性敘述與管理政策呈現，較難透過單一量化指標完全標準化。因此，各公司在社會面向之揭露架構撰寫上往往保有更大的彈性空間，進而形成揭露內容與呈現方式之異質性。

因此，在 ESG 制度逐步標準化與監理強化之背景下，社會構面之揭露是否已形成相對穩定且一致之架構，抑或仍呈現高度差異性，值得進一步系統性分析。特別是在高度全球化且資本密集之半導體產業中，其 S 面向揭露是否因產業特性、公司規模或供應鏈角色不同而產生差異，尚缺乏針對產業之深入比較研究。

基於上述，本研究以台灣半導體製造業上市公司作為研究對象，以 2024 年公司所發布之永續報告書為基礎，系統性整理並分析各公司社會 (S) 面向之揭露架構與內容。藉由盤點整體揭露現況並透過架構分析進行分類與比較，檢視不同公司規模與類型，進一步探討公司之間差異對於揭露內容之可能影響因素。透過上述分析，本研究旨在釐清台灣半導體產業 S 構面揭露之共通性與異質性特徵，補充既有文獻較少著墨於產業內部揭露結構差異之研究缺口。

第二節、研究問題與研究目的

在既有 ESG 揭露文獻中，多數研究著重於揭露與企業績效之間的關聯與影響，較少深入探討同一產業內部企業之間在揭露架構與內容配置上的異質性。而在高度專業分工且全球嵌入程度極高的半導體產業中，即使面對相似制度規範與國際標準，不同企業之揭露實踐仍可能呈現結構性差異。因此，有必要針對產業內部之 S 構面揭露進行比較分析。

在可能影響揭露差異的因素中，公司規模與產業供應鏈位置具不同的理論意涵。首先，公司規模反映企業所承受之外部監督壓力與組織資源配置能力，規模較大之企業可能在 S 構面揭露上展現較高之系統性與完整性。其次，企業於產業供應鏈中之功能角色，則影響其勞動結構、製程風險與社會責任焦點，進而形塑其社會議題之重大性排序與揭露邏輯。

基於上述，本研究提出以下研究問題：

1. 台灣半導體製造業上市公司之 S 構面揭露架構整體呈現何種共通性與差異性？
2. 公司規模是否影響半導體企業在 S 構面揭露架構與內容深度之差異？
3. 企業在半導體產業供應鏈中的功能位置，是否影響其 S 構面揭露議題之結構設計與重點配置？

第二章、文獻回顧

第一節、ESG 架構的社會（S）構面之內涵與演進



一、利害關係人理論

Freeman 於 1984 年提出利害關係人理論（Stakeholder Theory），主張企業之存在並非僅為股東利益服務，而應該同時考量員工、供應商、消費者、社區與政府等多元利害關係人之利益。該理論與傳統股東至上觀點相反，強調企業經營決策需回應不同利害關係人之期待與權益保障，並認為企業長期價值之創造取決於其與各類利害關係人之穩定互動關係。Awa、Etim 與 Ogbonda（2024）的研究進一步強調，若 CSR 缺乏與利害關係人之實質互動，可能流於形式性揭露，甚至成為掩飾企業問題之工具。因此，CSR 之制度意涵應建立於利害關係人理論所強調之多方責任與價值共創基礎之上。

二、社會（S）構面之意涵

ESG 的概念於聯合國全球契約組織（UN Global Compact）所發布的《Who Care Wins》（2004）報告中被首次提出，旨在呼籲企業將環境、社會於治理三大因素納入決策之中，而後又於責任投資原則（UN PRI）（2006）中將確立了 ESG 作為具體投資評估的標準。其中，該框架中的社會（S）構面所關注的是企業在其經營過程中，如何與各類利害關係人互動，並履行其社會責任。其主要涵蓋與人相關之議題，包括員工權益與勞動條件、人權保障、職場安全與健康、多元與平等、顧客關係、社區參與，以及供應鏈管理等面向。

在實務運作上，社會（S）構面之評估通常圍繞著內部與外部利害關係人之權益展開。根據目前國際主流之永續揭露框架，如全球報告倡議組織（GRI）與永續會計準則委員會（SASB）之規範，社會構面之考量維度主要可歸納為三大核心面向：首先是「人力資本管理」，聚焦於勞雇關係、員工培訓、多元包容（DEI）及職業安全衛生；其次為「人權與社區影響」，涵蓋原住民權利、社區參與以及對營運所在地之社會經濟貢獻；最後則是「責任商業行為」，包含供應鏈的人權盡職調查、數據隱私與消費者保護等（GRI, 2021; SASB, 2018）。這些

維度共同構成了企業社會績效的評價基礎，旨在衡量企業如何平衡經濟利益與社會公平。



然而，儘管社會（S）構面在 ESG 架構中已具備一定之分類與指標體系，其內涵仍呈現高度的情境依賴性與解釋彈性。一方面，社會議題涉及之利害關係人範圍廣泛，且不同產業、國家與制度環境下，對於員工權益、人權保障或供應鏈責任等議題之關注程度與實踐方式皆有所差異（劉念琪、戴曉惠、鄭明哲，2025）；另一方面，多數社會面向之指標具有質性特徵，難以透過一致且標準化之方式加以衡量（Wass, 2021）。此種特性使企業在進行 ESG 揭露時，對於社會構面之議題選擇、指標詮釋與揭露深度，具有相對較高之裁量空間，進而導致揭露資訊呈現高度異質化且缺乏可比性（Hess, 2019）。

因此，相較於環境與治理構面逐步趨於量化與標準化，社會構面之資訊揭露更易受到企業策略考量與外部壓力之影響，進而呈現出內容與形式上的差異。此一現象亦導致不同企業在面對相似社會議題時，其揭露方式與重點存在顯著不一致，形成 ESG 報告中社會構面資訊之高度異質性。基於此，後續研究有必要進一步檢視特定產業中企業於社會構面之揭露差異，以釐清其呈現特徵與可能影響因素。

第二節、ESG 資訊揭露之現況與準則

一、全球揭露的標準化趨勢

隨著全球資本市場對非財務資訊揭露（Non-financial Disclosure）的重視，為提升資訊的可比性、一致性與透明度，多個國際組織與機構分別發展出系統化的 ESG 揭露準則。本研究將回顧目前國際企業最廣泛採納且具高參考價值的框架，這些框架不僅規範了企業揭露的範疇，更形塑了利害關係人評價企業社會績效之基準，而下文將針對主流準則於社會構面之要求進行說明：

1. 全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）

GRI 準則為目前國際最廣泛採用的永續揭露標準之一，全球前 500 大企業中有超過半數以上公司使用該準則作為永續報告書編制基礎 (KPMG, 2023)。在 S 構面中，GRI 400 系列專題準則主要針對企業之社會影響進行揭露規範，整體涵蓋與利害關係人相關之多元議題。其內容大致可歸納為幾個面向，包括以員工為核心的勞動與就業實務、人權相關議題、企業對社區與供應鏈之社會影響，以及顧客與市場責任等。透過此一分類架構，GRI 提供企業在社會構面揭露上的基本指引以及建議撰寫項目，使不同企業在報告內容上具備一定程度之可比較性。

2. 永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB)

SASB 準則則以投資人決策為核心，強調財務重大性，涵蓋環境、社會資源、人力資源、商業模式與創新、領導力及公司治理五大面向，並依據 77 個行業特性建立產業別揭露框架。於社會 (S) 構面中，SASB 並未採用統一之通用分類，而是依各產業之營運特性與風險暴露，聚焦於對企業財務表現具有潛在影響之社會議題，例如勞動管理、產品安全、資料隱私或供應鏈管理等。此種產業導向之設計，使企業在揭露內容上更具針對性與決策相關性，有助於提升不同企業間之可比較性。

3. 責任商業聯盟 (Responsible Business Alliance, RBA)

RBA 為全球電子與半導體產業廣泛採用之供應鏈責任標準，主要針對勞工權益、健康與安全、環境保護及商業道德等議題訂定行為準則。相較於 GRI 與 SASB 等通用型揭露框架，RBA 更具產業導向特性，特別聚焦於供應鏈管理與勞動條件等社會 (S) 構面核心議題，並透過稽核與評估機制強化企業對供應鏈責任之落實。在半導體產業中，多數企業已依循 RBA 準則進行供應鏈管理與相關資訊揭露，使其成為實務上影響企業社會責任揭露內容的重要依據之一。

4. 國際標準化組織社會責任指引 (International Organization for Standardization, ISO)

ISO 26000 為國際標準化組織 (ISO) 所發布之社會責任指引，旨在提供企業與各類組織於實踐社會責任時之參考原則與行動方向。其內容涵蓋組織治理、人權、勞動實務、環境、公平營運實務、消費者議題以及社區參與與發展等核心主

題，其中多數面向與社會（S）構面高度相關。該指引並非用於績效衡量或資訊揭露之標準，而是偏重於提供企業在實務操作層面之行為參考依據，協助其將社會責任內化於組織運作之中。



誠如研究背景所述，相較於環境（E）與治理（G）構面已逐漸形成較為一致之揭露架構，社會（S）構面所涵蓋之議題範圍較廣，涉及員工管理、人權保障、多元平等、職業安全、人才發展及供應鏈勞動管理等多個面向，因此不同國際準則與評估機構對於社會議題之分類方式亦存在差異。例如，GRI 400 系列將社會議題區分為僱傭關係、勞資關係、職業安全衛生、訓練與教育、多元平等及人權評估等主題；SASB 於半導體產業中則特別強調人力資本發展、勞工管理及員工健康與安全等重大性議題；RBA 則從勞工、人權與職業安全等面向建立供應鏈管理規範；而 ISO 26000 則將社會責任區分為人權、勞工實務、公平營運實務、消費者議題及社區參與等核心主題，強調組織對各利害關係人之責任與影響。

綜合上述國際揭露準則與評估框架可發現，雖然各機構對社會構面之分類方式與關注重點不盡相同，但其核心內容多圍繞於人力資本管理、人權保障、多元平等、人才培育以及職業安全與健康等議題。然而，現有架構多從規範或評估角度出發，較少反映企業於永續報告書中實際採用之揭露方式與章節配置。因此，本研究進一步參考前述國際準則內容，並結合半導體產業樣本企業之實際揭露情形，於後續分析歸納建立核心主題，以提升不同企業間揭露內容之可比較性。

二、組織透明化之內涵與揭露原則

組織透明化（Organizational Transparency）指企業在資訊揭露過程中，使利害關係人能夠獲取、理解並評估與組織相關之重要資訊之程度。Albu 與 Flyverbom（2016）指出，組織透明性並非單純資訊揭露之結果，而是一種經由選擇、篩選與詮釋所建構的過程。而根據 Schnackenberg 與 Tomlinson（2014），組織透明化可被界定為一種由資訊揭露所形成之知覺品質，其核心構成包含資訊的揭露程度（disclosure）、清晰性（clarity）與準確性（accuracy），三者共同影響

利害關係人對組織行為之理解與判斷。此一觀點強調，透明化並非單純資訊的「有無」，而是資訊在傳遞過程中是否具備可解讀性與可信度。



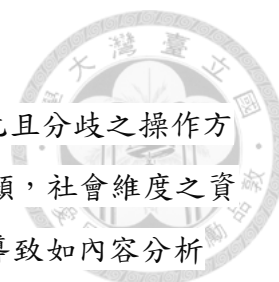
進一步而言，企業透明度可以被視為一種制度性資訊機制，其本質涵蓋資訊之生成、驗證與傳播過程，並以降低企業與外部利害關係人之間的資訊不對稱為主要目的（Bushman et al., 2004）。在此架構下，透明化不僅關乎揭露的數量，更涉及資訊是否具備一致性、可驗證性與可比較性，使外部觀察者能有效評估企業之實際行為與績效。換言之，透明化是一種結合資訊品質與治理機制之系統性產出，而非單一維度之揭露行為。

在 ESG 社會構面之情境中，組織透明化具有關鍵意義。相較於環境構面多以標準化指標進行量化揭露，社會構面由於涉及勞動條件、人權風險與供應鏈管理等議題，其指標往往缺乏統一的物理計量基礎，具有高度的解釋彈性（Galant & Cadez, 2017）。在此情況下，企業是否揭露其管理流程、風險辨識機制與實際執行狀況，便成為判斷其社會績效揭露品質之重要依據。若揭露僅停留於政策宣示或選擇性資訊呈現，則可能產生「說」與「做」的脫鉤，導致即便形式上符合準則，仍欠缺實質透明性（Wickert et al., 2016）。此種透明化程度之差異，亦為後續文獻分析 ESG 社會構面揭露異質性之重要理論基礎。

第三節、ESG 社會構面揭露之實務與研究現況

一、揭露實務與衡量挑戰

在建立國際主流揭露準則之基礎後，學界與實務界進一步關注企業如何落實這些標準，以及揭露品質之優劣。現有關於 ESG 社會構面揭露之文獻，主要圍繞著揭露動機、資訊特徵以及對企業績效之影響展開。在衡量方法上，學術界長期以來視企業之自願性揭露為觀察其社會參與程度之關鍵途徑。早期研究如 Abbott 與 Monsen（1979）即提出透過內容分析法（Content Analysis）對企業年報中之社會責任資訊進行編碼，將質化之描述轉化為具備比較性之數據，並建立以企業揭露內容作為衡量其社會參與程度之操作方法，為後續相關實證研究提供重要方法論基礎。



而後續文獻指出企業社會責任（CSR）之衡量方法存在多元且分歧之操作方式。根據 Galant 與 Cadez（2017）對歷年 CSR 衡量方法之回顧，社會維度之資訊往往具備高度的質性特徵，且因缺乏統一的物理計量單位，導致如內容分析法、第三方評級指標或問卷調查等不同衡量途徑所產出的結果可能存在顯著落差。該研究進一步指出，由於企業揭露內容與其實質社會績效之間並非總是呈現線性關聯，因此賦予了企業在報告撰寫上更大的裁量空間。亦即，在缺乏標準化衡量基礎的情況下，企業傾向於根據自身利益或外部利害關係人之偏好，對揭露之深度與廣度進行選擇性調整。此種衡量與揭露之落差，顯示在現行揭露機制下，企業社會構面資訊仍存在顯著之不一致性與可比性問題，亦引發後續文獻進一步探討其形成原因。

另一方面，從整體 ESG 文獻之發展脈絡觀之，既有研究多聚焦於 ESG 與企業財務績效或整體永續表現之關聯性分析，對於各構面內涵與揭露內容之細緻比較則相對有限。Barbosa 等人（2023）透過系統性文獻回顧指出，現有 ESG 研究中，被高度關注之主題多集中於企業財務績效與永續性之關聯，而針對各構面內涵及其對應指標之分析仍屬少數。其中，社會（S）構面因涉及員工、供應鏈與人權等多元且難以量化之議題，其揭露內容之系統性比較與分析更顯不足。此一研究落差顯示，在現有文獻中，對於企業如何實際呈現社會構面資訊之探討仍有進一步深化之必要。

二、揭露差異的理論解釋

企業在社會構面揭露上所呈現之差異，並非僅源自衡量方法之限制，亦與其所處之制度環境、組織特性與利害關係人壓力密切相關，而探討驅動企業進行社會維度揭露之深層動機，多與制度壓力（Institutional Pressure）相關（Campbell, 2007）。根據合法性理論（Legitimacy Theory），企業為了獲得社會大眾與利害關係人之認同，通常傾向於透過揭露積極的社會績效資訊，以證明其營運符合社會期望與價值規範（Suchman, 1995）。特別是在全球化競爭壓力下，企業揭露社會資訊不僅是為了展現自律，更是為了回應來自政府法規、投資機構及供應鏈客戶之制度性要求（Campbell, 2007）。然而，這種受到外部壓力而驅動的揭露實

務，亦可能導致企業在議題選擇上呈現策略性傾向，即優先披露符合主流價值或易於量化之績效，而對具爭議性或涉及深層人權治理之議題則採取較為模糊之表述。

根據利害關係人理論，企業面對之利害關係人類型眾多，包含員工、顧客、供應商、社區、政府與投資人等，各群體對企業社會責任之期待具有多樣性與情境依存性（Awa et al., 2024）。企業在回應不同利害關係人訴求時，往往需依其產業特性、組織規模與制度環境調整社會責任實踐方式，進而反映於揭露內容之差異化。而 Russo 與 Perrini（2010）也指出，不同規模與組織特性的企業，其 CSR 實踐邏輯存在差異。大型企業多以利害關係人理論為基礎，透過正式制度與報告機制回應外部監督；中小企業則較依賴社會資本與關係網絡，其責任實踐往往呈現較為非正式與情境導向的特徵。此一差異顯示，CSR 揭露形式並非單純制度合規結果，而可能反映企業組織特性與策略導向之差異。此觀點亦為理解同一產業內企業在 S 構面揭露架構上的差異提供理論基礎。

第四節、供應鏈治理下社會（S）構面之重要性

隨著全球供應鏈分工日益細緻，企業社會責任之內涵已逐漸由單一企業內部之治理議題，擴展至跨組織之供應鏈管理。根據 Gereffi (2018) 的全球價值鏈（Global Value Chains）架構，當代資本主義的運作特徵在於領頭廠商透過「私人治理」機制，定義並監督其全球供應網路的行為準則，這使得社會責任之範圍不再侷限於法律實體邊界，而是隨價值鏈延伸至各級供應商。過去企業在社會（S）構面之責任，多聚焦於內部員工福利與勞動條件；然而，在高度依賴外部供應商的全球化體系下，企業必須確保其經濟擴張伴隨著勞工權益的「社會升級」。換言之，企業不僅需對自身之勞動實務負責，亦需回應供應鏈中可能存在之勞動剝削、人權風險與工作環境問題，以避免因供應鏈端之社會風險而損及組織之長期價值與聲譽。Baid 與 Jayaraman（2022）的研究更指出，積極管理供應鏈中 S 構面的企業，不僅能降低營運風險，還能建立更具韌性的供應夥伴關係，從而獲得長期競爭優勢。

在此脈絡下，供應鏈治理機制逐漸成為推動社會構面落實之重要制度安排。既有研究指出，跨國企業與品牌商透過供應商行為準則（Supplier Code of Conduct）、第三方稽核機制及資訊揭露要求，將社會責任由核心企業向外延伸，形成一種以市場為導向之供應鏈治理模式（Locke & Samel, 2018）。此類機制使供應商在勞動條件、職業安全及人權保障等議題上須符合特定標準，進而強化整體供應鏈對社會構面之關注程度（Distelhorst et al., 2017）。特別是在電子與半導體產業中，由於其高度國際化與專業分工特性，供應鏈成員之間的依賴關係密切，使此類治理機制更具影響力。

進一步而言，此種供應鏈治理已由企業間的「自願性準則」演變為具法律約束力的「貿易規範」。林映均與蔡奉真（2025）指出，美國與歐盟正透過將人權與環境標準納入供應鏈責任，並輔以貿易制裁作為執行手段。這種法規化的趨勢，使得上游核心企業對中下游企業的影響力，從單純的市場契約轉向實質的合規要求。對於位居全球供應鏈核心的半導體產業而言，這意味著 S 構面的揭露不再僅是品牌聲譽的維護，更是確保產品能進入國際市場的必要條件。

然而，Schilling-Vacaflor（2021）指出，現行供應鏈規範在人權與環境議題的整合上仍存在落差，且針對社會（S）構面之規範多偏重於程序性的管理流程（Procedural requirements），而非實質性的績效指標。這種規範特徵導致企業在揭露社會維度資訊時，具備較大的解釋彈性與裁量空間。一方面，S 構面多涉及勞動條件與人權等具情境性與質化特徵之議題，其資訊取得與驗證相對困難；另一方面，供應鏈跨越多層次與多地區，使相關資訊呈現高度分散與不對稱之特性。此一特性不僅增加企業在揭露社會資訊時之複雜性，亦使不同企業在議題選擇與揭露方式上呈現顯著差異。而雖然領頭廠商透過供應商行為準則進行治理，但實務上仍存在顯著的倫理困境。Clarke 與 Boersma（2017）便以蘋果公司為例，指出即便具備完善的稽核制度，供應商在成本壓力與彈性生產的拉鋸下，仍可能出現勞工人權與環境保護的違規行為。這種「制度失靈」的現象說明了為何僅從企業揭露的程序性資訊，難以完全窺視供應鏈端的實質社會績效。因此，如何在供應鏈脈絡下理解企業社會構面之揭露內容與其差異性，成為當前研究關注之重要議題。

第三章、研究方法

第一節、研究架構



本研究主要採用內容分析法，以系統性方式檢視 20 間企業永續報告書中社會（S）構面之揭露內容，作為分析企業社會責任實踐與資訊呈現差異之依據。

首先，透過文獻回顧釐清 ESG 社會構面之理論內涵、揭露準則及既有研究之衡量方法，據以建立分析架構之理論基礎。接下來依據各公司於報告書中所呈現之 S 構面子議題進行編碼與分類，歸納其揭露架構之組成方式，包含主要議題、子項目及具體指標等層級內容。透過跨公司比較，分析不同企業在 S 構面揭露上的共通性與差異性，並進一步觀察其揭露內容之深度與細緻程度。

在此基礎上，本研究進一步從兩個面向進行差異分析。其一，依據公司規模進行分組，比較不同規模企業在 S 構面揭露架構與內容深度上的差異；其二，依據企業於半導體產業供應鏈中的功能定位進行分類，探討其對揭露議題選擇與內容配置之影響。

最後，將實證分析結果與文獻回顧中所整理之理論架構與揭露準則進行對照，檢視企業實際揭露行為與理論規範之間的落差，並回應本研究所關注之三項核心問題：台灣半導體製造業上市公司之 S 構面揭露架構之共通性與差異性、公司規模對揭露內容之影響，以及企業在產業供應鏈中之角色對揭露重點之影響。

綜上所述，本研究之分析邏輯可分為三個層次：透過 20 家樣本企業永續報告書之內容分析，觀察半導體產業整體之社會構面揭露特徵；其次，以企業規模作為分類依據，比較不同規模企業於揭露廣度與揭露深度之差異；最後，再依據企業於半導體產業價值鏈中的功能位置進行分類，探討不同產業鏈角色之揭露策略與內容配置差異。

整體而言，本研究建構出一個以「分析層次」與「揭露程度」為核心之 3×2 分析矩陣（如表一所示），其中三個分析層次分別為整體產業、企業規模及產業

鏈位置，而兩項分析面向則為揭露廣度與揭露深度，以系統性比較不同企業群體於社會構面揭露之差異。

表一、研究分析架構矩陣

分析層次	揭露廣度	揭露深度
整體產業（20 家樣本企業）	✓	✓
規模分析（高／次高／中／低）	✓	✓
產業鏈分析（製造／封裝／製造封裝混合）	✓	✓

第二節、研究對象與資料來源

一、資料來源

本研究採用內容分析法，以台灣半導體上市企業作為樣本進行個案分析。分析樣本包含台灣積體電路製造股份有限公司、日月光投資控股股份有限公司、聯華電子股份有限公司等共 20 間企業。

本研究以上述 20 間公司於官方公開管道所發布之永續報告書作為文本分析資料，並以 2024 年發布之版本為主要分析對象。

二、研究對象

1. 產業選擇邏輯

半導體產業具高度全球化之供應鏈結構，價值鏈分工明確，涵蓋設計、製造及封裝測試等不同功能，使其在社會（S）構面上除企業內部治理外，亦涉及供應鏈管理、勞動條件及人權風險等跨組織議題。此一特性因而使其成為觀察企業回應供應鏈社會責任要求之重要場域。因此，本研究選擇半導體產業作為研究對象，主要基於其在全球供應鏈中的關鍵地位及所面臨之高度制度壓力：

- I. 供應鏈合規壓力：半導體產業除受各國政府與資本市場對永續資訊揭露之制度性要求外（如台灣金管會對上市公司永續報告之規範，及歐盟企業永續報告指令等），亦深受供應鏈治理機制影響。其中，責任商業聯盟（RBA）作為電子產業最主要的供應鏈標準，針對勞工權益、健康與安全等社會構面有

嚴格的稽核機制（Validated Assessment Program）。根據 RBA 年度報告，半導體企業往往是接受 VAP 稽核次數最多的族群之一，其中，台灣於 2023 年全球 RBA VAP 稽核場次中排名全球第二，佔全球總數約 8%（Responsible Business Alliance，2023），這使得該產業在 S 構面的揭露具備更高度的強制性合規特徵。

- II. 投資人重視程度：從投資人觀點來看，國際機構廣泛採用之 ESG 評估機制亦將人力資本管理視為半導體產業的重要永續議題。根據 MSCI ESG Ratings 的統計，半導體產業在「人力資本開發」與「勞工管理」的權重通常佔其 S 構面評分之 25% - 30%。由於半導體業屬於高度人才密集產業，人才留任與人權治理被投資人視為影響財務表現的重大性因素（Materiality），這促使該產業企業在報告書中須更深入地回應相關指標。

2. 企業選擇邏輯

本研究選擇截至 2024 年，半導體產業鏈中中下游負責製造與封裝並持續發布五年永續報告書之半導體上市公司作為研究對象（如表二所示）。

半導體產業鏈可概略區分為上游設計、中游晶圓製造，以及下游封裝測試與模組應用等不同環節，其產業鏈分工如圖一所示。在此分工架構下，本研究聚焦於中下游之製造與封裝測試環節。之所以聚焦於製造與封裝測試環節，主要是因該類企業在社會（S）構面上具有較高之議題暴露程度。相較於設計環節，製造與封測企業通常具備勞動密集及實體廠區運作之特性，其社會議題多涉及勞動條件、職業安全與健康風險，以及供應鏈相關之勞動管理，使相關揭露內容相對具體且可被觀察。

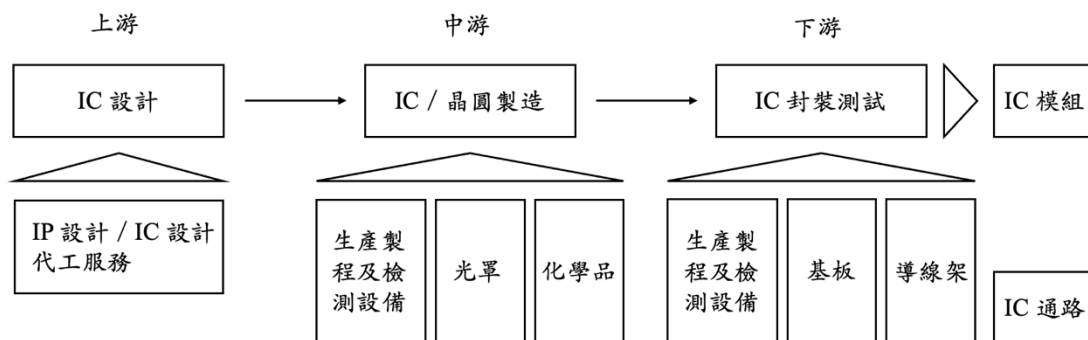
此外，製造與封裝測試企業位於全球供應鏈之關鍵節點，其營運活動與多層次合作關係密切，因而使社會構面之責任不僅限於企業內部，亦延伸至供應鏈層級，進一步提升相關議題之揭露重要性。

另一方面，本研究選擇納入持續發布五年永續報告書之企業，則主要是考量長期揭露行為較能反映企業在資訊揭露上的制度化程度與穩定性，使其揭露內容較具一致性與結構性，亦有助於提升跨企業比較分析之可行性。



而本研究為探討公司規模與揭露程度之關聯性，選擇採用員工人數與營業收入作為企業規模之衡量指標。考量樣本企業在兩項指標上呈現連續分布，未存在明確分界，故本研究依各企業於樣本中的相對排序進行綜合判斷，將企業劃分為高規模（員工人數破萬且營業收入高於千億）、次高規模（員工人數破五千且營業收入高於兩百億）、中規模（營業收入高於一百億）與低規模（營業收入低於一百億）四類。本次個案企業之規模分布如下：

- I. 高規模：台積電、日月光、聯電
- II. 次高規模：力成、京元、華邦電、景碩、南茂
- III. 中規模：南亞科、旺宏、超豐、京鼎、台勝科、順德
- IV. 低規模：華東、宇瞻、華泰、台亞、界霖、矽統



圖一、半導體產業鏈概況

表二、樣本概述

公司名稱	所屬產業鏈位置	2024 員工人數 (人)	2024 營業收入 (億)	本研究判定規模
聯華電子股份有限公司	製造	19161	2323	高規模
華泰電子股份有限公司	封裝	5145	14.1	低規模
台灣積體電路製造股份有限公司	製造	84512	28940	高規模
旺宏電子股份有限公司	製造/封裝	3813	258.83	中規模
台亞半導體股份有限公司	製造/封裝	788	42	低規模
華邦電子股份有限公司	製造	8097	816.1	次高規模
順德工業股份有限公司	封裝	1387	108.15	中規模
矽統科技股份有限公司	製造/封裝	194	7.39	低規模
南亞科技股份有限公司	製造	3687	341.3	中規模
超豐電子股份有限公司	封裝	4292	152.13	中規模
京元電子股份有限公司	封裝	10911	268.56	次高規模
景碩科技股份有限公司	封裝	6401	305.34	次高規模
京鼎精密科技股份有限公司	封裝	3208	164.54	中規模
台塑勝高科技股份有限公司	製造	1482	124.22	中規模
日月光投資控股股份有限公司	封裝	84148	5954.09	高規模
界霖科技股份有限公司	製造/封裝	286	50.27	低規模
力成科技股份有限公司	封裝	17134	733	次高規模
華東科技股份有限公司	封裝	1505	50.09	低規模
南茂科技股份有限公司	封裝	5922	227	次高規模
宇瞻科技股份有限公司	封裝	598	78.37	低規模

註：樣本公司依股票代號順序排列。

第三節、內容分析法



一、內容分析法

內容分析法（Content Analysis）為一種以系統性程序分析文本內容之研究方法，並於早期由 Berelson（1952）加以界定，認為其目的在於對溝通內容進行客觀、系統且可量化之描述。此方法強調在既定的分類架構下，透過一致之編碼規則將文本資料轉化為可分析之單位，以降低研究者主觀判斷之影響，並提升分析結果之可比較性與再現性。

本研究將採用內容分析法檢視企業永續報告書中社會（S）構面之揭露內容，透過建立分類架構並進行系統性編碼，以 5 項主類別以及 21 項子類別分別歸納各企業之揭露項目與內容配置，進而分析其在揭露架構與深度上的差異。詳細實施之步驟如下：



圖二、內容分析流程圖

二、研究變數界定

為系統性比較不同企業於社會（S）構面之揭露表現，本研究建構兩項量化指標，分別為「揭露廣度」與「揭露深度」，以捕捉企業在揭露範圍與資訊細緻程度上的差異。其定義與計算方式如下：

1. 揭露廣度定義

揭露廣度目的是為衡量企業於既定分析架構下之議題涵蓋程度，藉此檢視企業 ESG 報告是否於多個子分類構面中提供具體數據資訊，以提升利害關係人對其社會（S）永續表現之理解與信任。而本研究將依據前述內容分析所建立之分類架構，將社會（S）構面拆分為若干子類別，並針對每一家公司，檢視其是否

於各子類別中揭露至少一項相關指標。若該類別中出現任一具體揭露內容，則記為 1，若未出現相關資訊則記為 0。經逐項判定後，各子類別之結果加總所得之數值，即為該公司之揭露廣度分數。該指標反映企業在社會構面議題上之涵蓋範圍，數值越高，代表其揭露面向越為廣泛。

2. 揭露深度定義

揭露深度用以衡量企業於社會（S）構面中所提供資訊之細緻程度與豐富性。不同於僅判斷是否揭露，揭露深度著重於各子類別中具體揭露內容之數量。對於每一家公司，統計其在各子類別下所提供之具體指標數量，例如同一議題中若同時提供多項分項數據，則各項皆納入計算。最終，將各子類別中之指標數量加總，作為該公司之揭露深度分數。舉例來說，當在「全體員工分布」的子類別中提供了依性別、依年齡、依學歷共三種數據，其深度分數就是加總後的 3。此一指標可反映企業在資訊揭露上的細節程度與內容豐富度，數值越高，代表其揭露資訊越為完整且具體。

三、分析單位界定

本研究之分析單位以企業永續報告書中涉及社會（S）構面之「具體揭露資訊」為核心，並以是否包含可辨識之量化或半量化資料作為納入標準。具體而言，本研究選擇聚焦於與人力資源與員工相關之揭露內容，凡報告書中涉及員工結構、勞動條件、教育訓練、職業安全與健康，以及多元與平等議題，且同時提供數據、比例、次數或其他具體指標之資訊，皆納入分析範圍。相較之下，僅具敘述性、宣示性而未附具體數據支持之內容，則不列入主要分析單位。

在資料形式上，本研究所納入之分析單位不限於單一呈現方式，而涵蓋文本敘述與量化資料兩類型。前者包含報告書段落中直接描述相關指標之文字內容，後者則包括各類統計表格、圖表或數據彙整資訊。透過此種方式，得以全面掌握企業在社會（S）構面中之實際揭露情形，並作為後續編碼與分類之基礎。



四、資料編碼

為將文本資料轉化為可分析之結構化資訊，本研究依據內容分析法之原則，對樣本企業永續報告書進行系統性編碼。整體編碼過程可區分為兩個階段：資料擷取與類別建構。

1. 資料擷取與初步標記

首先，針對樣本企業之永續報告書進行逐篇檢視，辨識符合本研究分析單位界定之資訊內容。凡涉及社會（S）構面且同時包含具體揭露指標與對應數據之文字敘述或數據呈現，皆納入編碼範圍，並以一致之標記方式記錄於資料整理表中。此一過程主要目的在於自原始文本中擷取可供比較之基本分析資訊，並建立後續分類之基礎資料庫。

2. 類別整合與架構建構

在完成初步資料擷取後，本研究進一步對已標記之內容進行整理與歸納。由於不同企業在揭露同一議題時，常存在指標名稱、數據呈現方式及定義標準之差異，故需透過比對與整合，將性質相近之揭露內容歸納為統一之分析類別。此一過程透過反覆檢視與比較，逐步形成具一致性之分類架構，並建立各項揭露內容與分類項目之對應關係，以利後續揭露廣度與揭露深度之計算與分析。

編碼範例（以兩性薪酬差異為例）：

第一階段初步標記之內容：

- 男女基本薪資比率
- 男女標準薪資比
- 男女最低起薪比
- 男女平均報酬比例

第二階段整合後之揭露指標標題：

- 「兩性基本薪酬差異」

五、分類架構之建構

由於既有文獻中較少針對企業永續報告中社會構面揭露內容建立以「實際揭露資料」為基礎之分類系統，僅陳華羚（2025）以金融業為研究對象，建立社會構面揭露內容之分類架構，故本研究以其歸納方式與結果為基礎進行調整發展分類架構。首先透過檢視樣本企業永續報告書之內容配置與揭露模式，歸納企業於社會構面中實際呈現之主要議題與指標類型；其次，參酌國際常用之永續揭露準則（如 GRI），作為分類項目之概念基礎與補充依據。透過上述過程，將原始分散之揭露內容加以整合，形成具一致性之分類體系，以反映企業在社會（S）構面之實際揭露結構。

第四章、研究結果

第一節、分類架構之建構結果



在完成初步編碼與指標標準化後，本研究進一步將整理後之揭露項目進行概念層級之整合與歸納。此舉相較於單純依循報告書原有章節架構進行分類，反而更著重於從各企業揭露內容中辨識其背後所反映之人力資源管理核心議題，並透過跨企業的比較，整合為具有共通性的主題類型。

研究過程首先檢視各樣本企業於永續報告書中對於社會（S）構面之章節安排與議題描述，並比對其實際揭露之量化指標內容。由於不同企業在章節命名與議題劃分上存在顯著差異，例如相似概念可能分散於「人才」、「員工關懷」、「幸福職場」或「社會責任」等不同標題之下，故本研究未直接採用原始分類，而是進一步透過語意分析與內容比對，將性質相近之揭露項目進行重新歸類。

一、第一層核心主題分類

在此過程中，研究重點並非章節名稱本身，而是其所涵蓋之實質揭露內容。例如，「人才永續」、「員工發展」與「教育訓練」等不同表述，皆可視為對應於人才培育之概念；而「友善職場」、「幸福職場」與「員工關懷」則多涉及工作環境與福利條件之議題。透過此種跨文本之整合方式，本研究得以排除形式差異，聚焦於揭露內容之本質意涵。

最終，依據標準化指標之分布情形與主題集中程度，總共歸納出五項具代表性之核心主題，作為後續分析之第一層分類架構，依序分別為：（1）人力資源與人才流動、（2）人權保障與多元平等、（3）人才培育與發展、（4）薪酬福利與職場環境，以及（5）職業安全與健康。

上述分類不僅反映樣本企業在社會（S）構面中對於員工相關議題之主要揭露範疇，亦提供一套具備可比性之分析架構，使不同企業之揭露內容得以在統一標準下進行橫向比較，並作為後續揭露廣度與深度分析之基礎。下表為本研究經

分類後所歸納之 20 家樣本公司 ESG 報告書社會相關章節內容，其中表格內括號所標示之數字係對應上段各核心主題編號：



表三、樣本公司報告書章節與分類主題對照表

文本來源公司	原始揭露章節名稱	文本原始議題分類	本研究分類架構
聯華電子股份有限公司	安心職場	1. 尊重人權 2. 職場多元共融 3. 守護員工職場環境	(2) 人權保障與多元平等 (1) 人力資源與人才流動 (3) 人才培育與發展 (4) 薪酬福利與職場環境 (5) 職業安全與健康
華泰電子股份有限公司	人才永續	1. 人才永續 2. 友善職場 3. 人才發展與教育 4. 勞工安全與健康	(1) 人力資源與人才流動 (2) 人權保障與多元平等 (4) 薪酬福利與職場環境 (3) 人才培育與發展 (5) 職業安全與健康
台灣積體電路製造股份有限公司	員工引以為傲的公司	1. 共融職場 2. 人才吸引與留任 3. 人才發展 4. 職業安全與衛生	(2) 人權保障與多元平等 (4) 薪酬福利與職場環境 (1) 人力資源與人才流動 (3) 人才培育與發展 (5) 職業安全與健康
旺宏電子股份有限公司	社會面向	1. 尊重員工 2. 學習發展 3. 工作生活的平衡	(1) 人力資源與人才流動 (2) 人權保障與多元平等 (4) 薪酬福利與職場環境 (3) 人才培育與發展 (5) 職業安全與健康
台亞半導體股份有限公司	員工關係與照護	1. 員工權益 2. 人才發展 3. 人才招募 4. 員工福利 5. 職業安全衛生	(2) 人權保障與多元平等 (3) 人才培育與發展 (1) 人力資源與人才流動 (4) 薪酬福利與職場環境 (5) 職業安全與健康
華邦電子股份有限公司	人權與社會共融	1. 人權管理 2. 人才管理 3. 員工共好 4. 職業健康安全 5. 社會共融	(2) 人權保障與多元平等 (4) 薪酬福利與職場環境 (1) 人力資源與人才流動 (2) 人權保障與多元平等 (5) 職業安全與健康 (3) 人才培育與發展
順德工業股份有限公司	社會責任	1. 人才培育 2. 職業安全與衛生 3. 人權維護	(1) 人力資源與人才流動 (3) 人才培育與發展 (4) 薪酬福利與職場環境 (5) 職業安全與健康 (2) 人權保障與多元平等
矽統科技股份有限公司	員工關係	1. 勞資/勞雇關係 2. 員工結構 3. 薪酬管理 4. 員工福利 5. 培育發展 6. 職場健康與安全	(2) 人權保障與多元平等 (1) 人力資源與人才流動 (4) 薪酬福利與職場環境 (4) 薪酬福利與職場環境 (3) 人才培育與發展 (5) 職業安全與健康
南亞科技股份有限公司	人才	1. 人權 2. 多元共融	(2) 人權保障與多元平等 (1) 人力資源與人才流動

		3. 人才發展	(3) 人才培育與發展
		4. 安心職場	(4) 薪酬福利與職場環境
			(5) 職業安全與健康
超豐電子股份有限公司	和諧職場	1. 員工結構分布	(1) 人力資源與人才流動
		2. 員工人才留任	(1) 人力資源與人才流動
		3. 員工人才培育	(3) 人才培育與發展
		4. 重視員工人權	(2) 人權保障與多元平等
		5. 員工福利權益	(4) 薪酬福利與職場環境
		6. 員工關懷溝通	(5) 職業安全與健康
		7. 員工健康安全	(5) 職業安全與健康
京元電子股份有限公司	員工照護	1. 人力資本	(1) 人力資源與人才流動
		2. 薪酬與福利	(4) 薪酬福利與職場環境
		3. 多元發展	(3) 人才培育與發展
		4. 職場安全	(5) 職業安全與健康
		5. 人權政策	(2) 人權保障與多元平等
景碩科技股份有限公司	友善職場	1. 人才政策與承諾	(2) 人權保障與多元平等
		2. 人力資源結構	(1) 人力資源與人才流動
		3. 人才培育與發展	(3) 人才培育與發展
		4. 薪酬福利	(4) 薪酬福利與職場環境
		5. 人權維護：傾聽員工的聲音	(2) 人權保障與多元平等
		6. 職場健康安全	(5) 職業安全與健康
		7. 全方面健康照護	(5) 職業安全與健康
京鼎精密科技股份有限公司	共融幸福社會	1. 幸福職場：薪酬與福利	(2) 人權保障與多元平等
		2. 人才吸引與留任	(4) 薪酬福利與職場環境
		3. 員工培力	(1) 人力資源與人才流動
		4. 職業安全衛生	(3) 人才培育與發展
		5. 健康照護	(5) 職業安全與健康
台塑勝高科技股份有限公司	營造安全職場	1. 人權保障與雇用	(1) 人力資源與人才流動
		2. 員工薪酬與福利	(2) 人權保障與多元平等
		3. 人才培育與發展	(4) 薪酬福利與職場環境
		4. 工作環境安全	(3) 人才培育與發展
			(5) 職業安全與健康
日月光投資控股股份有限公司	包容職場	1. 人才吸引與留任	(1) 人力資源與人才流動
			(2) 人權保障與多元平等
		2. 人才培育與發展	(4) 薪酬福利與職場環境
		3. 職業健康與安全	(3) 人才培育與發展
			(5) 職業安全與健康
界霖科技股份有限公司	幸福職場管理揭露	1. 多元化佈局與招募	(1) 人力資源與人才流動
		2. 人才培育與發展	(2) 人權保障與多元平等
		3. 健全福利與退休制度	(3) 人才培育與發展
		4. 健康與安全照顧	(4) 薪酬福利與職場環境
			(5) 職業安全與健康
力成科技股份有限公司	包容職場	1. 員工結構與多元性	(1) 人力資源與人才流動
		2. 員工福祉	(2) 人權保障與多元平等
		3. 人才發展	(4) 薪酬福利與職場環境
		4. 人權守護	(3) 人才培育與發展
		5. 勞資溝通	(2) 人權保障與多元平等
		6. 職場健康與安全	(2) 人權保障與多元平等
		7. 員工關懷	(5) 職業安全與健康
			(5) 職業安全與健康

華東科技股份有限公司	社會關懷	1. 勞雇關係 2. 訓練與教育 3. 職業健康與安全 4. 員工多元化與平等機會 5. 人權管理	(1) 人力資源與人才流動 (3) 人才培育與發展 (5) 職業安全與健康 (2) 人權保障與多元平等 (4) 薪酬福利與職場環境 (2) 人權保障與多元平等
南茂科技股份有限公司	共融職場	1. 人才吸引與留任 2. 整體獎酬與福利 3. 人才發展 4. 人權維護 5. 健康與安全職場	(1) 人力資源與人才流動 (4) 薪酬福利與職場環境 (3) 人才培育與發展 (2) 人權保障與多元平等 (5) 職業安全與健康
宇瞻科技股份有限公司	友善及健康職場的好伴	1. 人員概況 2. 員工安全與健康 3. 員工福利與溝通 4. 人才培育與薪酬制度	(1) 人力資源與人才流動 (5) 職業安全與健康 (2) 人權保障與多元平等 (3) 人才培育與發展 (4) 薪酬福利與職場環境

綜合樣本企業之章節標題與議題歸納結果可以發現，儘管各企業在 ESG 報告書中對社會（S）構面之章節命名與結構安排存在顯著差異，但其實質揭露內容仍呈現出高度的主題收斂現象。多數企業雖使用如「安心職場」、「幸福職場」、「員工關懷」或「人才永續」等不同表述方式，然其內涵大致可歸納至人力資源流動、人權與多元、人才發展、薪酬福利及職業安全等核心議題，顯示企業在社會構面之關注重點具有一定程度之共通性。

進一步觀察亦可發現，不同企業在議題整合與分類方式上呈現出兩種傾向：部分企業傾向採用較高層次之整合式分類，將多項議題集中於單一章節之中；另一部分企業則採取較細緻之拆分方式，將相近議題分別獨立呈現。此種分類策略之差異，反映企業在揭露架構設計上之彈性，同時也導致不同報告書在資訊呈現形式上存在可比性不足之問題。

此外，從議題分布情形來看，「人才培育與發展」、「人才吸引與留任」以及「職業安全與健康」為多數企業普遍揭露之核心內容，顯示半導體產業在高度勞動密集與技術導向之特性下，對人力資本管理與職場安全議題具有較高之重視程度。相較之下，「人權保障與多元平等」與「勞資關係」相關議題雖亦出現於多數企業報告中，但其揭露深度與具體指標呈現仍存在差異。



二、第二層子類別分類

第二層子類別架構之建構，為參考陳華玲（2025）之研究所歸納之分析框架，並依據半導體產業永續報告書之實際揭露內容與分類邏輯進行調整與修正。例如，考量樣本企業普遍未揭露實習生相關資訊，故未將其納入本研究之子類別範疇；此外，亦依據產業常見揭露項目對部分子類別進行整併與細部重構，以提升分析架構與產業實務之契合度。

而本研究透過比對各企業在社會（S）構面中涉及人力資源相關之敘述與量化指標，將其內容依性質加以拆解，並歸納至人力資源與人才流動、人權保障與多元平等、人才培育與發展、薪酬福利與職場環境，以及職業安全與健康等五大主題之下。而最後所歸納出共 20 項子類別以及標準化後之揭露指標內容如下表所示：

表四、樣本公司報告書分層類別與標準化揭露指標

第一層（核心主題）	第二層（子類別）	標準化揭露指標
人力資源與人才流動	員工人口分布	全體員工分布 全體員工分布（依性別） 全體員工分布（依年齡） 全體員工分布（依學歷） 全體員工分布（依國籍） 全體員工分布（依地區） 員工職位身分（職務類別） 員工職位身分（勞顧合約） 員工職位身分（依生產類別） 外國籍員工 身心障礙員工 原住民員工
	員工流動	新進人員統計 新進人員統計（依性別） 新進人員統計（依年齡） 新進人員統計（依身分） 新進人員統計（依學歷） 新進人員統計（依地區） 離職員工統計 離職人員統計（依性別） 離職人員統計（依年齡） 離職人員統計（依身分） 離職人員統計（依學歷） 離職人員統計（依地區） 自願離職率 內轉率

		留任率 晉升率 招募成本
人權保障與多元平等	性別平權	女性員工比例（依身分） 兩性薪酬差異（依身分） 主管性別比例 女性升遷
	少數群體與外籍員工平權措施	文化與特別假期 協助適應措施
	人權保障	人權相關訓練狀況 申訴案件
	勞資溝通	工會參與 勞資會議 多元溝通管道 員工意見調查
	員工敬業度	敬業度與滿意度調查
人才培育與發展	員工訓練	總體訓練時數 總體訓練時數（依性別） 總體訓練時數（依雇用類型） 總體訓練時數（依職位） 總體訓練費用 訓練課程滿意度 特定主題訓練實施 數位學習實施 新進人員訓練 財務回報
	論調歷練（職涯發展）	內部填補
	績效考核	績效考核覆蓋率 績效考核覆蓋率（依性別） 績效考核覆蓋率（依生產類別） 績效考核覆蓋率（依職級）
薪酬福利與職場環境	薪酬	薪資總額 薪資平均數 薪資中位數 調薪 基本薪資比率
	生育相關福利	產假申請狀況 育嬰留職停薪 育嬰留職停薪（依性別） 子女福利與教育補助 托育與哺乳支持
	生育以外福利	員工結婚補助 員工社團補助 退休金 其他補助
	假期	生育與家庭相關假期給予 特休假
	員工活動	社團活動 休閒設施與服務 健康活動 特定員工活動

職業安全與健康	工時	工時 缺勤統計
	傷病情形	傷病統計（涵失能傷害頻率、失能傷害嚴重率、職業病、損失日數等）
	職場安全衛生	職業安全衛生教育訓練 職業安全衛生委員會 工作環境監控
	健康管理	健康檢查人次/受檢率 健康檢查金額 臨場醫療服務 健康相關講座與活動 員工心理與關懷服務 健康風險管理 防疫與疫苗
	承攬商管理	危害告知與宣導教育訓練 施工受傷管理 健康關懷

資料來源：本研究整理，修正自陳華羚（2025）

三、標準化揭露指標對應內涵

承接前述分類架構之建構結果，本節進一步說明各項標準化揭露指標所對應之具體內涵。由於不同企業在永續報告書中對於相似議題之揭露方式與指標設計存在差異，本研究透過指標標準化與分類整合，將原始多樣化之揭露內容轉化為具一致性之分析單位（如附表一所示，將「整合前指標索引」轉化為「整合後指標名稱」作為揭露深度與廣度之計算依據）。基於此，本節將依據前述分類架構，逐一說明各核心主題及其所涵蓋之子類別內涵，並界定各類別中標準化指標之意義與範圍。

1. 人力資源與人才流動

在人力資源與人才流動主題之建構過程中，本研究觀察到多數樣本企業於永續報告書中，皆以不同形式揭露與員工結構、招募與流動相關之資訊。儘管各企業在章節命名上有所差異，例如以「人才永續」、「員工概況」或「人力資本管理」等方式呈現，但其內容多圍繞於員工人數組成、性別與年齡分布、人才進用與離職情形等基本人力資源指標。基於此，本研究將相關揭露內容加以整合，歸納為「人力資源與人才流動」之核心主題。

另一方面，從揭露頻率與內容分布來看，此類議題亦為各企業在社會（S）構面中最為普遍且著墨最深之部分。相較於其他主題，人力資源相關資訊多具備明確之量化指標與長期追蹤特性，使企業能夠以較高程度之標準化方式進行揭露。因此，本研究將其視為分析企業社會構面揭露差異之重要基礎，並作為後續比較不同企業揭露廣度與深度之關鍵面向之一。

I. 員工人口分布

根據本研究對台灣半導體產業樣本企業之分析結果，員工人口分布為企業在人力資源揭露中最具基礎性與普遍性的量化指標之一，20 間企業皆於永續報告書中提供相關數據。另外，此類指標具備高度標準化特性，主要以員工人數與比例為核心，並透過不同分類維度呈現企業人力結構之全貌。

整體而言，個案企業多以「全體員工規模」作為揭露起點，進一步依據性別、年齡、教育程度、國籍、職務類別、職級階層、工作地點及雇用型態等進行細部拆分。其中，以「性別」與「年齡」為最普遍揭露之基本分類維度，多數企業皆同時提供人數與比例資訊，顯示此類指標已逐步形成產業揭露之共通基準。此外，部分企業亦進一步揭露如「職務類型（如生產與非生產人員）」、「管理職與非管理職分布」等資訊，使人力組成之分析更具層次性。

半導體產業在人口分布揭露上呈現出「多維度交叉分類」之特徵，例如同時結合性別與職級、性別與地區，或年齡與職務類型進行交叉分析，反映企業對人力結構分析之精細化趨勢。相較之下，部分企業則僅提供單一維度之統計數據，顯示不同公司在揭露深度上仍存在差異。

在多元與弱勢族群相關揭露方面，本研究亦發現企業會針對特定族群提供額外資訊，包含身心障礙員工、女性員工及外國籍員工等。其中，「女性員工比例」幾乎為所有企業之必揭露項目，且部分企業進一步揭露女性於主管階層或特定職務類別之分布情形；另在身心障礙員工方面，除基本人數與比例外，亦有企業提供依性別、年齡或地區之進一步分類。相對而言，原住民或

其他少數族群之揭露則較為有限，顯示該類議題在產業中的揭露程度仍有提升空間。



II. 員工流動

相較於員工人口分布主要反映企業人力結構之靜態特徵，員工流動相關指標則著重於人力資源之動態變化，包含招募、流失、內部流動與留任等面向。而根據本次研究結果，新進與離職人員人數為一致且主要的呈現數據，顯示「進出人力規模」已成為半導體產業中最基本之揭露內容。

在新進人員方面，多數企業皆提供全體新進人數或比例，並進一步依性別、年齡或地區進行分類。例如，聯電、台積電及日月光等大型企業，不僅揭露整體新進規模，亦細分不同人口特徵，部分企業甚至進一步揭露依職位階層或廠區之新進人員結構，反映其在人力補充來源分析上的細緻程度。

在離職人員揭露方面，所有樣本企業皆提供離職人數或離職率之基本資訊，並普遍依性別與年齡進行分類。值得注意的是，部分企業（聯電、台積電、華邦電、南亞科、日月光、力成）進一步揭露「自願離職率」，使外部利害關係人得以區分主動流失與被動調整之差異；此外，亦有企業揭露依地區、職務類別或國籍之離職率，顯示其對人力流失風險之掌握程度較高。

除基本之進出人力數據外，部分企業亦揭露進階之人力流動指標，包括內部轉職率、晉升率及關鍵人才留任率等。然而，該類指標在樣本企業間之揭露程度差異較大，僅少數企業進行系統性揭露，顯示此類進階人力管理資訊尚未形成一致之揭露標準。

2. 人權保障與多元平等

在人權保障與多元平等主題之歸納過程中，本研究發現，多數樣本企業於永續報告書中皆有涉及相關議題之揭露，惟其呈現方式與內容範圍存在較大差異。部分企業以「多元共融」、「性別平權」或「職場平等」等主題呈現，另有企業則將相關內容納入「人權政策」或「員工權益保障」等章節之中。儘管表述形式

不一，其核心多圍繞於反歧視政策、多元族群保障、性別平等措施及人權管理制度等面向，顯示此類議題在企業社會責任實踐中已具一定之共通性。因此，本研究將上述內容加以整合，歸納為「人權保障與多元平等」之核心主題。

然而，相較於人力資源相關之量化指標，人權與多元議題之揭露多偏向制度性與政策性描述，具體量化數據相對有限，且各企業在揭露深度與細緻程度上差異較為明顯。部分企業僅提供原則性宣示，另有企業則進一步揭露具體推動措施與成效指標。此種揭露形式之差異，使該主題成為觀察企業在社會（S）構面中揭露品質與實質投入程度之重要面向之一。

I. 性別平權

在半導體產業中，性別結構與薪酬公平性已逐漸成為評估企業人力資源管理與永續發展的重要面向。相較於其他社會議題，性別相關指標具備較高的量化特性，因此多數企業已建立基本的揭露架構。

其中，女性員工比例為最普遍揭露之指標，超過半數企業皆提供整體女性員工占比，並進一步依職位階層、職務類別或地區進行細分。

在薪酬平等方面，兩性薪酬比率為企業常態性揭露項目。多數企業提供男女薪資或總報酬之比較，部分企業更依職務類別、職級或廠區進行細分，以呈現更細緻之薪酬結構。然而，不同企業在指標定義與計算方式上仍存在差異，例如有些以平均薪資為基礎，有些則以總報酬或基本薪資比較，使得跨企業間之可比性仍受到一定限制。

而在性別平權之深化揭露方面，台積電、旺宏、日月光、界霖與南茂等企業亦關注女性於組織中的發展機會與晉升情形。揭露女性主管比例、女性管理階層占比或女性晉升相關指標，反映企業嘗試從「人數結構」延伸至「職涯發展」之觀察。然而，此類指標之揭露仍未普及，其餘多數企業尚未系統性呈現女性於不同職級之流動與發展狀況。



II. 少數群體與外籍移工平權措施

少數群體與外籍移工相關議題在半導體產業中之揭露程度明顯較低，且內容呈現高度分散之特性。整體而言，多數企業未將此類議題作為主要揭露重點，即使有所提及，亦多以零散描述為主，缺乏一致之量化指標。僅部分企業如日月光與力成針對外籍移工提供適應性課程與支持措施，而華邦電則揭露原住民族相關假別之使用比例，且相關揭露多屬個別措施或制度說明，尚未形成具系統性之揭露架構，顯示此類議題在現行 ESG 社會構面中仍處於相對邊緣之位置。

III. 人權保障

多數樣本企業已建立基本之人權管理機制，並透過教育訓練、申訴管道與案件處理情形等方式進行揭露。整體而言，企業普遍揭露人權相關訓練之參與情形（如訓練人次、時數或完訓率），以及申訴案件之受理與處理狀況，顯示企業已逐步將人權議題納入制度化管理範疇。部分企業亦進一步細分申訴類型，如性騷擾、歧視或職場不法侵害等，提升揭露內容之具體性與可辨識性。

然而，在「人權違反事件」之揭露上，多數企業多採敘述性方式說明「當年度未發生重大違反人權事件」或「未有相關案件」，而較少提供具體量化數據或長期趨勢比較。僅少數企業進一步揭露違反勞動法規、歧視或騷擾等案件數量，顯示此類指標之揭露尚未形成一致且標準化之呈現方式。

IV. 勞資溝通

多數樣本企業已揭露基本之溝通機制，其中以工會參與及勞資會議為最普遍之揭露內容。企業多透過揭露參與工會員工人數或比例、勞資會議召開次數等指標，呈現勞資互動之基本運作情形，顯示此類制度性溝通機制已成為半導體產業之揭露基礎。然而，仍有部分企業未提供相關量化數據，僅以制度描述方式說明，反映其在資訊透明化程度上仍存在差異。

進一步觀察可發現，企業在「多元溝通管道」之揭露上差異較為明顯。部分企業除傳統勞資會議外，亦建立員工意見平台、申訴機制、座談會或問卷調查等多元溝通形式，並進一步揭露案件數量、處理率或回覆時效等具體數據；然而，亦有企業僅簡要描述相關制度，未提供實際運作情形之量化資訊。

V. 員工敬業度

在「員工敬業度」子類別中，整體揭露程度相對有限，僅部分企業揭露基本之敬業度或滿意度調查結果，並以整體分數或問卷執行情形作為主要呈現方式。進一步觀察可發現，僅聯電提供較具延伸性的揭露內容，如依性別、職級或其他特徵進行分群分析，或將敬業度結果轉化為具體指標（如敬業員工比例）加以呈現。相較之下，多數企業尚未將敬業度數據與實際管理措施或人力資源策略進行連結，使其揭露多停留於結果呈現層次。整體而言，半導體產業在員工敬業度議題上仍以基礎揭露為主，於指標深化與應用層面仍有發展空間。

3. 人才培育與發展

人才培育與發展為人力資源管理中之核心構面之一，主要反映企業如何透過制度化訓練與能力培養機制，提升員工專業能力並支持組織長期發展。相較於單純的人才招募或留任，此一構面更著重於企業對人力資本之持續投資，因此亦為多數企業於社會（S）構面中揭露程度較高且內容較為具體之重要主題。

I. 員工訓練

員工訓練的內容多以提升專業技術能力與強化組織運作效率為核心目的，並透過量化指標呈現訓練投入情形。整體而言，各企業普遍揭露「訓練總時數」、「平均每人訓練時數」及「訓練參與人次」等基礎指標，並多進一步依性別、職級、職務類別或生產類別等進行訓練時數之拆分，呈現不同員工群體在訓練資源配置上的差異。

此外，企業亦會進一步針對訓練內容進行細緻化揭露，將訓練依主題或類型加以區分，例如區分為專業技術訓練、管理職能訓練、通識課程及環安衛相關訓練等。部分企業更進一步揭露特定訓練計畫或課程內容（如數位轉型、AI 應用、ESG 相關培訓等），使訓練揭露不僅停留於量化投入層面。然而，整體而言，多數揭露仍集中於投入面（如時數與費用），對於訓練成果與長期效益之量化衡量仍相對有限，僅聯電、華邦電、力成與南茂有特別分別提及投資報酬率、課程合格率與人才發展投入經費等面向，且內容往往較為單一。

II. 論調歷練

輪調歷練相關資訊在樣本企業中之揭露程度相對有限，僅少數企業（台積電、華邦電、南亞科、宇瞻）針對內部人才流動與職務歷練機制進行量化說明。而現有揭露多集中於內部職缺填補率、內部晉升比例及跨單位輪調情形等指標，主要用以呈現企業透過內部人才培養機制進行人力配置與職涯發展之情形。

III. 績效考核

多數企業皆以「績效考核覆蓋率」作為揭露接受定期績效考核之員工人數或比例、績效考核完成率的基礎指標，並且依性別、職級與生產類別等進行拆分揭露，呈現不同員工群體參與績效考核之情形。

4. 薪酬福利與職場環境

薪酬福利與職場環境為企業回應員工基本需求與提升工作滿意度之核心面向，主要涵蓋薪資制度、福利措施及工作環境相關議題。此一構面直接反映企業對員工福祉之投入程度，因此亦為多數企業揭露內容較為多元且形式較為彈性之主題。然而，不同企業在揭露範圍與分類方式上差異較大，顯示該構面在標準化程度上仍有發展空間。

I. 薪酬

在薪酬的揭露部分，多數企業皆選擇以非主管全時員工之薪資平均數與薪資中位數作為揭露基礎，其中華泰、京元更進一步揭露「平均調薪幅度」之資訊。另有部分企業亦補充說明薪資成長相關指標，然而其表達方式與計算基準並不一致，例如以薪酬變動比率、平均薪資增減幅度或整體薪資成長率等不同形式呈現，影響不同企業之間的可比較性。

而部分企業亦延伸揭露薪酬分配之結構性資訊，例如最高薪酬與一般員工薪資中位數之比率、不同職級或生產類別之薪資差異，以及基層員工起薪與法定最低工資之比較等，反映薪資公平性與內部差距情形。

II. 生育相關福利

在生育相關福利之揭露方面，本研究發現其為各項社會（S）指標中標準化程度最高的類別之一。個案所以企業皆已建立共通且一致的揭露架構，並特別集中於「育嬰留職停薪」相關指標，包括符合資格人數、實際申請人數、復職人數，以及進一步延伸之復職率與留任率等，並普遍區分為「全體」與「依性別」兩種層級進行呈現。

除核心指標外，部分企業亦進一步揭露產假與陪產假使用情形，以及新生兒人數等補充性資訊，使整體揭露內容由制度面延伸至實際發生之人口動態。然而，在其他生育支持措施方面，各企業揭露重點則呈現較大差異。例如部分公司提供生育補助、育兒津貼或子女教育補助之金額與受惠人次，而亦有企業揭露托育設施、哺乳支持或合作機構數量等制度性資源，顯示在標準化指標之外，企業多依自身政策重點選擇不同補充揭露方向。

III. 生育以外福利

相較於生育相關福利之高度標準化揭露，生育以外補助之內容則呈現出明顯之多元性。有相關揭露之企業呈現內容涵蓋各種面向，從員工生活支持、財務補助及組織文化活動等面向提供福利措施，擴展至結婚與喪葬補助、三節與生日禮券、語言學習補助、團體保險，以及員工社團與活動補助等項目。然而，部分企業（如華泰）雖於報告中提及相關補助措施之存在，但未進一

步揭露具體之量化數據或受惠情形，致使其資訊難以納入後續指標化分析，故未列入本研究之統計範圍。



IV. 假期

多數個案企業於永續報告書中皆提及提供符合法規或優於法規標準之各類假期制度，顯示企業普遍重視員工休假權益之保障。然而，在量化揭露方面，僅華邦電與力成針對有薪假與特休假提供較為具體之數據資訊，其餘企業多以制度性說明或政策描述為主，未進一步揭露實際使用情形或相關統計數據。此外，雖部分企業於報告中揭露產假相關資訊，然多以申請人數或實際使用人次等方式呈現，性質上較接近生育相關福利之使用情形，故本研究未將其納入本項假期類別之分析範圍。

V. 員工活動

員工活動之揭露內容相較於其他指標，呈現出高度多元且分散之特性。根據本研究整理，各企業多從「社團活動」、「休閒設施與服務」、「健康促進活動」以及「特定員工活動」等面向進行揭露，並透過活動場次、參與人數或使用人次等量化指標，呈現員工參與情形。整體而言，多數企業皆會揭露社團數量、活動參與人次或健康活動執行次數等基礎資訊，顯示企業普遍將員工活動視為提升員工凝聚力與身心健康之重要工具。

然而，相較於其他較具標準化趨勢之揭露項目，員工活動之內容差異明顯，不同企業依其組織文化與資源配置，發展出各具特色之活動形式。例如，部分企業著重於運動與健康促進活動，揭露健走、減重競賽或健康檢測參與情形；亦有企業強調社團發展與員工自發參與，提供社團數量與成員結構之統計；另有企業透過家庭日、節慶活動或公益參與等方式，強化員工與組織之連結。此類揭露雖能呈現企業文化與員工關懷之多樣性，但由於指標定義與分類方式差異較大，使得跨企業之比較性相對有限。

5. 職業安全與健康

職業安全與健康為企業在人力資源管理與永續經營中之核心議題之一，主要關注員工於工作場域中的身體安全與健康狀態。依據國際永續揭露準則（GRI 403），職業安全與健康不僅涵蓋職業災害之預防與管理，亦包括健康促進措施、職場風險控管及員工健康支持系統等面向。隨著高科技製造產業對於作業環境與製程安全之要求日益提高，企業在此面向之制度建構與資訊揭露亦逐漸受到重視。

就本研究分析結果而言，「職業安全與健康」之相關內容在各樣本企業中具有高度出現頻率，且多以具體量化指標進行呈現，例如職業災害發生率、失能傷害頻率（LTIFR）、健康檢查覆蓋率及健康促進活動參與情形等，顯示該主題具備較高之制度成熟度與揭露一致性。相較於其他較偏向策略或文化導向之議題，此類指標多具有明確定義與計算方式，使其成為跨企業間較具可比較性之揭露面向。

I. 工時

工時議題主要涉及員工工作負荷與勞動時間安排，並與職業安全與健康密切相關。依據本研究觀察，半導體產業在揭露工時相關資訊時，並未將其作為獨立主題進行系統性說明，而多半置於職業安全、健康管理或傷病統計等段落中作為補充性資訊，反映企業傾向將工時視為影響職場安全與員工健康風險之重要因素之一。

從揭露內容來看，各企業多以「總工時」、「依性別或廠區區分之工時統計」以及「缺勤率」等指標呈現工時相關情形，但整體揭露程度相對有限，且缺乏如平均工時、加班時數或工時結構等更具解釋力之指標。此一現象顯示，儘管工時為影響員工身心健康與職災風險之關鍵因素，企業在資訊揭露上仍偏重結果性指標（如傷病或缺勤），而非對工時本身進行深入揭露。

II. 傷病情形

傷病情形之揭露主要用以反映企業在職業安全管理與風險控制方面之實際成果，透過量化指標掌握職場中發生之各類職業傷害與健康風險。根據本研究

分析，半導體產業在此子類別之揭露已發展出高度一致且標準化之指標體系，各企業普遍採用「失能傷害頻率（Frequency Rate, FR）」與「失能傷害嚴重率（Severity Rate, SR）」作為核心衡量指標，並輔以失能傷害件數、損失日數、職業傷害人數及職業病件數等資料進行補充說明。

此外，除上述核心指標外，多數企業亦進一步揭露更細緻之傷害類型分類，以補充說明職業傷害之發生情境與性質。例如，順德與京元將職業傷害區分為人因工程性、物理性及化學性等類型，並分別揭露其發生件數或比例；順德與超豐亦進一步細分具體事故型態，如跌倒、被夾、被捲、切割傷等，以呈現不同作業環境下之潛在風險來源。

相較於其他社會構面議題，傷病情形之揭露具有明確之計算方式與國際對應標準（GRI 403），使不同企業之數據具備高度可比性。此外，部分企業亦進一步依性別、廠區或勞動關係等面向進行細分，提供更細緻之風險分布資訊，顯示其在職業安全管理上已具備較成熟之資料蒐集與分析能力。

III. 職場安全衛生

職業安全衛生相關揭露內容涵蓋範圍廣泛，包括職業安全衛生委員會運作、教育訓練、工作環境監測與管理制度等面向，構成企業職安管理之主要實踐架構。

在職業安全衛生之教育訓練面向，多數樣本企業皆投入相當篇幅進行揭露，內容涵蓋訓練課程類型、辦理場次、參與人數及訓練時數等量化資訊。具體而言，除矽統、超豐與京鼎未提供相關量化揭露外，其餘個案企業多詳細說明年度訓練執行情形，並進一步區分一般安全衛生教育訓練、危害性作業訓練及緊急應變演練等不同類型，部分企業亦依對象（如新進員工、在職員工或高風險作業人員）進行分類統計，呈現高度多元性。整體而言，該子議題之揭露已呈現出高度制度化與量化趨勢，反映半導體產業對於職業安全風險管理之高度重視，並透過持續性教育訓練強化員工安全意識與應變能力。



IV. 健康管理

員工健康管理涵蓋生理與心理層面之整體照護，其揭露內容主要圍繞於健康檢查、臨場醫療服務、健康促進活動及員工心理關懷等面向。整體而言，半導體產業在此議題之揭露已具相當成熟度，特別是在健康檢查相關指標上，多數企業皆建立一致性較高之量化揭露方式，包含健康檢查參與人數、參與率、檢查頻率及不同族群（如性別、年齡、廠區）之細部統計。

進一步觀察可發現，部分企業除基本健檢外，亦延伸至癌症篩檢、特殊危害作業健檢及進階影像檢查等項目，並透過異常分級管理與追蹤機制，將健康檢查結果連結至後續健康管理行動，呈現由「檢查」走向「管理」之發展趨勢。然而，在揭露方式上，各企業仍存在差異，例如部分企業著重於檢查人數與參與率，另有企業則補充健康風險分布（如高、中、低風險比例）或檢查滿意度等資訊，顯示健康檢查相關指標雖具一定標準化基礎，但在揭露深度與呈現形式上仍未完全一致。

除生理健康外，心理健康與員工關懷亦逐漸成為企業揭露重點，多數企業皆提供員工協助方案（EAP）、心理諮商服務或關懷機制，並透過諮詢人次、滿意度或關懷追蹤人數等指標進行量化呈現。此外，健康促進活動之揭露亦相當多元，涵蓋健康講座、運動推廣、減重與戒菸活動等，顯示企業已由單一醫療支持，進一步轉向預防導向與生活型態管理之健康策略。

V. 承攬商管理

承攬商管理之揭露內容主要聚焦於施工安全、危害告知與教育訓練、以及承攬作業之職業災害管理等面向，反映企業對於非正式員工之工作安全與風險控管責任。然而，相較於其他人力資源相關議題，本研究發現，多數企業並未將承攬商管理作為獨立且完整之揭露主題，而多是分散於職業安全衛生、工安管理或供應鏈管理等章節中，於相關議題脈絡下附帶說明。此現象顯示，承攬商管理在目前揭露架構中仍屬「附屬性議題」，其重要性雖逐漸受到關注，但尚未完全發展為具獨立分類與系統性指標之揭露項目。

在具體揭露內容上，企業多集中於承攬商之危害告知與教育訓練，例如入廠安全訓練、作業許可制度及緊急應變演練等，並以訓練人次、訓練時數及參與覆蓋率等指標進行量化呈現；此外，部分企業亦進一步揭露承攬商之職業傷害指標，如失能傷害頻率（FR）、嚴重率（SR）、損失工時日數及死亡事故等。而承攬商管理之揭露仍呈現高度分散與不一致之特性。一方面，各企業在揭露範圍上差異顯著，有些著重教育訓練與制度建構，另有企業則偏重事故統計與風險管理；另一方面，指標選擇亦缺乏統一標準，使不同企業間之比較性受到限制。此一現象反映承攬商管理雖已納入 ESG 實務之重要範疇，但在揭露架構與指標標準化方面，仍有進一步整合與發展之空間。

第二節、變數分析之結果

一、揭露深度分析結果

1. 分析結果概述

本研究將 ESG 社會（S）構面中與人力資源相關之揭露內容，依據前述分類架構歸納為 20 項子類別，並以各企業於各子類別中所揭露之具體指標數量作為衡量基礎，進而加總形成該企業之揭露深度總分，以反映其在人力資源議題上的資訊揭露完整程度與細緻程度。

根據個案企業在本研究所設計之揭露指標框架下得到的總得分狀況，由高到低依序為下：

- I. 力成（65 項）
- II. 台積電（62 項）
- III. 南亞科（60 項）
- IV. 華邦電（59 項）
- V. 南茂（49 項）
- VI. 宇瞻、聯電（47 項）
- VII. 順德、景碩（45 項）



- VIII. 華泰 (41 項)
- IX. 台亞 (40 項)
- X. 日月光 (39 項)
- XI. 京元 (38 項)
- XII. 京鼎、華東 (37 項)
- XIII. 旺宏 (34 項)
- XIV. 界霖 (32 項)
- XV. 台勝科 (29 項)
- XVI. 超豐 (27 項)
- XVII. 矽統 (9 項)

2. 樣本企業內部揭露深度表現概況

進一步觀察各企業之揭露深度分布，可發現部分企業在多數子類別中皆有穩定揭露，呈現出跨議題的系統性資訊建構；相對而言，亦有企業僅於特定主題（如員工基本人口資料或職業安全）進行較為集中之揭露，其餘面向則相對缺乏，顯示其揭露模式偏向選擇性揭露。

此外，從子類別層級進行比較亦可看出揭露成熟度之差異。「員工人口分布」、「員工流動」、「員工訓練」等議題，多數企業皆有提供相對完整的指標內容，顯示該類議題已逐漸形成產業共通之揭露慣例；相對之下，「少數群體保障」、「承攬商管理」及部分補助性福利等子類別，則多呈現零散且不一致之揭露情形，顯示相關議題尚未建立穩定之揭露框架。其中，本研究將子類別所對應之指標總數大致分為三個等級：

I. 揭露層次高多元性指標（ ≥ 8 項）

以員工人口分布（11 項）、員工流動（17 項）及員工訓練（10 項）為代表，不僅普遍被多數企業納入揭露範圍，且多進一步提供細緻之分類與量化數據。此類議題多屬人力資源管理之基礎資訊，具備高度可量化與可比較之特性，因而逐漸形成產業中較為一致之揭露慣例。



II. 揭露層次中多元性指標（4－7 項）

包涵健康管理（7 項）、薪酬（5 項）、生育相關福利（5 項）、性別平權（4 項）等議題。此類議題多與企業內部管理制度、法規遵循及外部利害關係人期待密切相關，因而普遍受到企業重視。然而，儘管多數企業皆有進行揭露，其在指標選擇、分類方式與量化程度上仍呈現差異，顯示該類議題尚處於由多元實務逐步整合為標準化揭露架構之發展階段。未來若能進一步強化指標一致性與資料可比性，將有助於提升整體揭露品質。

III. 揭露層次低多元性指標（≤3 項）

包涵少數群體與外籍移工平權措施（2 項）、假期（2 項）、論調歷練（1 項）等。此類議題整體揭露項目數量偏少，且多數企業僅以概括性說明為主，缺乏系統性之量化指標，顯示其在揭露架構中仍屬相對邊緣之議題。然此類主題多涉及社會公平、勞動權益與供應鏈責任等關鍵面向，若揭露不足，可能影響企業於人權保障與社會責任之評價。因此，未來企業在相關議題上仍有提升揭露完整性與透明度之空間。

3. 產業整體揭露深度概況

整體分析結果顯示，各企業之揭露深度呈現明顯差異，總揭露指標數量由高至低分布範圍相當廣，最高可達約 65 項（力成），最低則不足 10 項（矽統），顯示企業在資訊揭露的完整性與細緻程度上存在顯著落差。此一差異亦反映出企業在 ESG 社會構面中對人力資源議題之重視程度與揭露策略並不一致。

本研究為進一步分析企業於 ESG 社會構面之揭露深度，首先依據各企業之總深度得分進行分級。整體評分滿分為 93 分，然樣本企業之實際得分最高為 65 分，顯示整體揭露程度尚未達理論上限，且分布呈現集中於中低分區間之特徵。

而在分數級距劃分上，本研究並未採用等距分組，而是依據樣本實際分布情形進行調整，以提高分類之解釋力。具體而言根據企業揭露深度得分將其分為四個階層：



I. 高深度揭露群 (≥ 55)

由於得分達 55 分以上之企業數量有限，且與其他企業存在明顯落差（除 60 分以上企業外，50 分以上 60 分以下之企業僅華邦電一家），顯示該群企業於揭露完整性與制度成熟度上具有相對領先地位。因此，本研究將 55 分以上之企業獨立劃分為最高級距，以突顯其差異性。

II. 中高深度揭露群 (45–55) 與中低深度揭露群 (35–45)

多數企業分布於 35 至 50 分區間內，顯示此區段為樣本之主要集中區域。為能進一步辨識其中揭露程度之差異，本研究將該區間細分為兩個級距 (≥ 45 、 ≥ 35)，以提升分析之細緻度。

III. 低深度揭露群 (< 35)

低於 35 分之企業在揭露內容與架構上相對簡略，且多缺乏系統性指標，因此劃分為最低級距，以反映其揭露發展仍處初期階段。

表五、揭露深度分析結果彙整表

級距	公司（依揭露深度得分結果）	產業鏈位置	規模
≥ 55	力成、台積電、南亞科、華邦電	製造 (3) 封裝 (1)	高 (1) 次高 (2) 中 (1) 低 (0)
≥ 45	南茂、宇瞻、聯電、順德、景碩	製造 (1) 封裝 (4)	高 (1) 次高 (2) 中 (1) 低 (1)
≥ 35	華泰、台亞、日月光、京元、京鼎、華東	製造 (0) 封裝 (5) 封裝/製造 (1)	高 (1) 次高 (1) 中 (1) 低 (3)
< 35	旺宏、界霖、台勝科、超豐、矽統	製造 (1) 封裝 (1) 封裝/製造 (3)	高 (0) 次高 (0) 中 (3) 低 (2)

在揭露深度分級結果中（如表五所示），可觀察到樣本企業於不同級距之分布並非平均，而呈現由少數高揭露企業帶動、其餘企業集中於中間區段之結構。具體而言，得分達 55 分以上之高揭露群僅占少數，顯示在半導體產業中，能夠

同時兼顧多項子議題並提供較完整指標揭露之企業仍屬有限。相較之下，多數企業落於 35 至 50 分區間，反映整體產業已具備一定程度之揭露基礎，但在內容完整性與細緻度上仍存在提升空間。

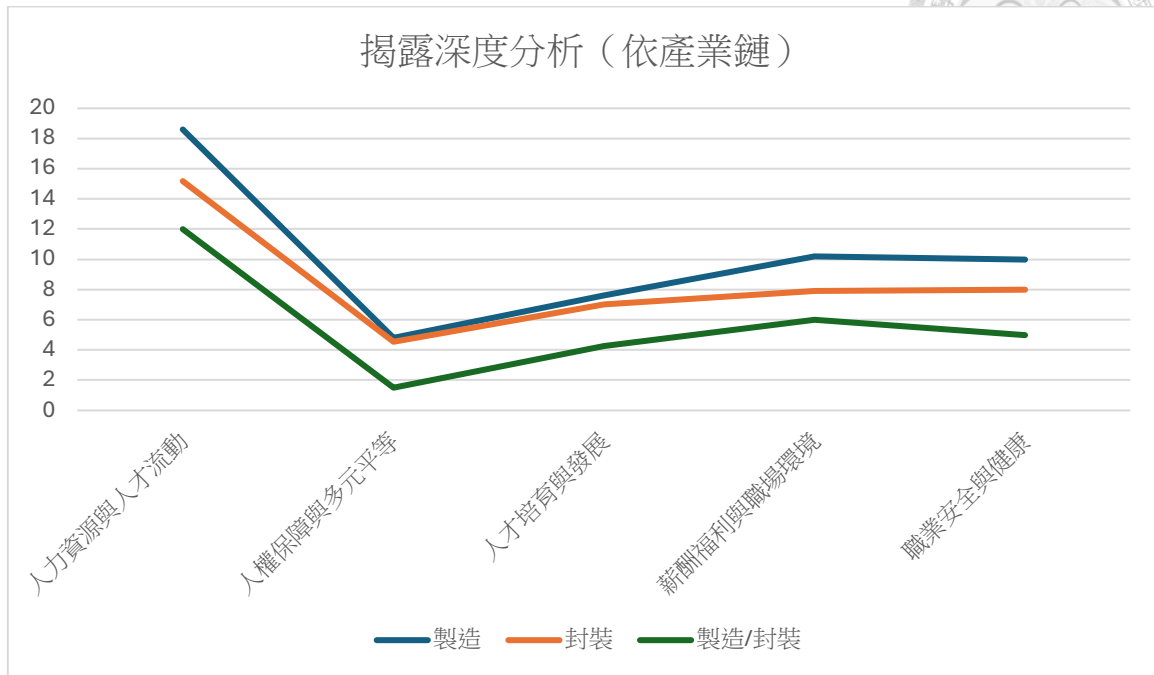


進一步從產業鏈位置觀察，高揭露群以製造端企業為主，顯示其在揭露深度上普遍具有較完整之制度化基礎與指標建構能力；而中高與中等級距中，則以封裝企業為主要構成，且分布較為分散，顯示封裝企業在揭露實務上呈現較大異質性。部分封裝企業已能達到接近製造業之揭露水準（如力成），但亦有企業仍停留於較為基礎之揭露階段，反映其在資源投入與制度成熟度上存在差異。

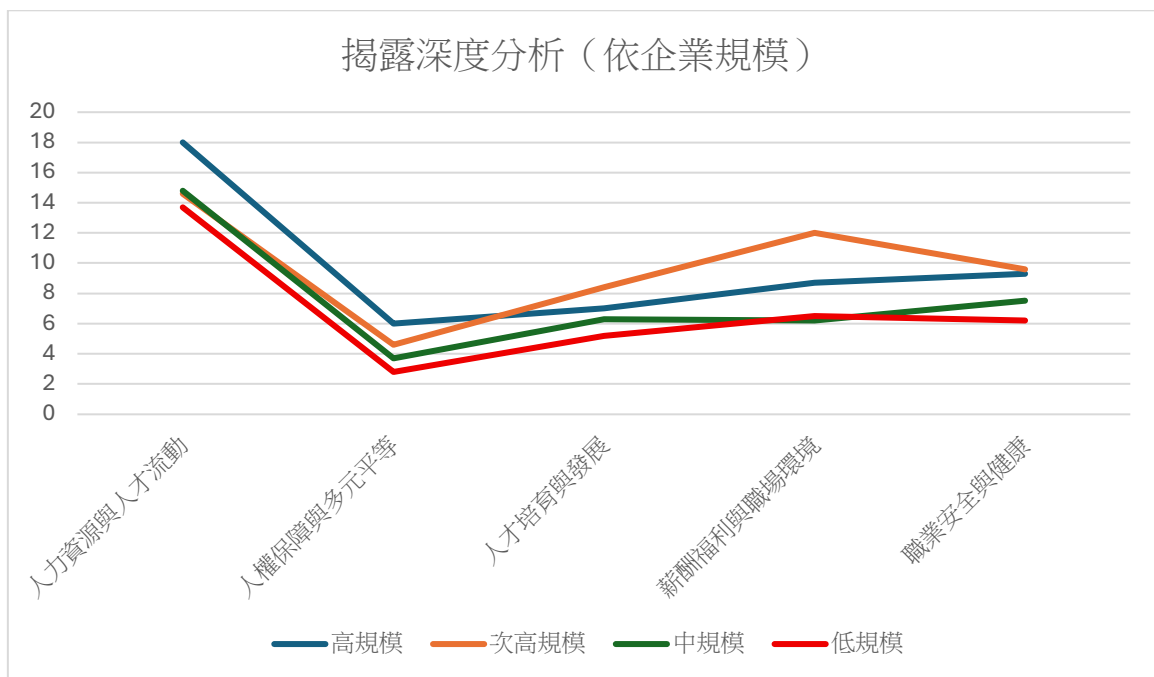
若結合公司規模進一步分析，可發現高深度揭露群多集中於規模較大或次大型企業，而中小規模企業則多分布於中低級距。此一結果顯示，揭露深度與企業規模之間具有一定程度之關聯性，大型企業較有能力投入資源建立完整之資料蒐集與揭露機制；相對而言，中小企業在揭露內容上則較傾向聚焦於部分核心議題，整體揭露架構與指標延伸性相對有限。

然而，仍有少部分低規模企業做到較全面之深度揭露。宇瞻在附表五之揭露深度分析結果中於部分子類別得分顯著高於低規模企業之平均表現，甚至與次高規模或中規模企業之表現並駕齊驅。深入探究其背後的產業特性，宇瞻作為全球工業級記憶體關鍵供應商，高度嵌入於高標準大廠價值鏈中（如 HP、Acer）。而依據全球價值鏈與供應鏈治理脈絡，這一定程度的反映出跨國領頭大廠透過 RBA 等合規稽核將 ESG 壓力向下傳遞，進而驅使宇瞻在面臨高度外部合法性壓力下，將有限資源策略性聚焦於核心社會指標的深化揭露。

圖三、樣本企業揭露深度分布（依產業鏈）



圖四、樣本企業揭露深度分布（依企業規模）



若進一步觀察樣本企業在各個核心主題中的揭露深度結果（圖三、四），亦能發現以下趨勢：

首先，就產業鏈位置而言，揭露深度仍然呈現明顯差異。整體來看，製造端企業在各構面之揭露指標數量普遍較高，於「人力資源與人才流動」、「薪酬福利與職場環境」及「職業安全與健康」等構面中皆維持相對領先水準；封裝企業於各構面之分布較為平均，且於人權與人才培育面向揭露狀況較好但揭露深度整體略低於製造業；而製造／封裝混合型企業則在多數構面中皆呈現最低之揭露水準。此一結果顯示，不同產業鏈位置之企業在揭露深度上存在系統性差異。

此外，觀察各構面之分布情形，可發現「人力資源與人才流動」為三類企業中揭露程度最高之構面，而「人權保障與多元平等」則為整體揭露相對不足之構面，各類企業於此構面之指標數量皆明顯偏低；其餘如「人才培育與發展」、「薪酬福利與職場環境」及「職業安全與健康」等構面，則介於中間水準，且不同產業鏈類型間仍維持相對一致之排序關係。

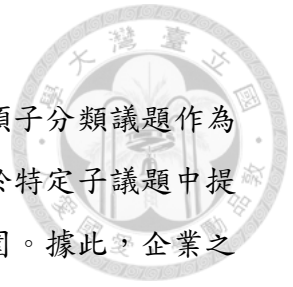
另一方面，就企業規模觀察揭露深度之差異，可發現揭露程度隨規模增加而呈現上升趨勢。高規模企業在各構面中普遍具有最高之揭露指標數量，且整體分布較為穩定；次高規模企業於部分構面（如薪酬福利與職場環境）之揭露程度甚至高於最高規模企業；而中規模與低規模企業則整體揭露水準較低，且於各構面之差異較小。此結果顯示，企業規模與揭露深度之間存在一定程度之正向關聯。

綜合而言，揭露深度之分析結果顯示，不論從產業鏈位置或企業規模觀察，樣本企業在不同構面間皆呈現一致之高低分布趨勢，且整體揭露集中於少數核心議題，其他構面之揭露程度則相對有限。

二、揭露廣度分析結果

1. 分析結果概述

本研究以企業在 ESG 社會（S）構面中對人力資源相關議題之「涵蓋範圍」作為揭露廣度之衡量基礎，著重分析企業於不同子議題上的揭露分布情形。相較於揭露深度聚焦於單一議題中資訊之細緻程度，揭露廣度則反映企業是否能在多個議題面向上提供基本且可辨識之揭露內容。



在分析方法上，本研究以前述五大核心主題所延伸之 20 項子分類議題作為判斷依據，逐一檢視各企業於各子議題中的揭露情形。凡企業於特定子議題中提供任一具體指標或明確說明，即視為該議題已被納入其揭露範圍。據此，企業之揭露廣度可透過其所涵蓋之子議題數量加以呈現，並作為比較不同企業揭露完整程度之基礎。而根據計算，揭露廣度之總得分情況由高到低分別為下：

- I. 台積電、華邦電、力成（18 類）
- II. 南亞科（17 類）
- III. 聯電、順德、京元、景碩、華東、南茂（15 類）
- IV. 華泰、超豐、京鼎、宇瞻（14 類）
- V. 台亞、日月光（13 類）
- VI. 台勝科、界霖（12 類）
- VII. 旺宏（10 類）
- VIII. 矽統（3 類）

2. 樣本企業內部揭露廣度表現概況

就揭露廣度之分布結果觀察，樣本企業在各級距間呈現明顯分層現象。整體而言，達到最高級距（ ≥ 17 類）之企業數量有限，僅少數企業能涵蓋多數子分類議題，顯示在半導體產業中，具備高度議題涵蓋能力之企業仍屬少數。相較之下，多數企業集中於中間級距（ ≥ 13 至 ≥ 17 類），反映產業整體已具備一定程度之議題揭露基礎，但在議題涵蓋完整性上仍存在差異。

觀察各樣本企業之揭露廣度分布，整體而言之表現呈現明顯分層現象，且並沒有任何一間企業內容滿足全部廣度面向。位於高揭露廣度群之企業（如台積電、華邦電與力成）已能涵蓋大多數子分類議題，顯示其在人力資源相關議題之揭露上，具備較完整之架構意識，並傾向於系統性回應多元議題。進一步觀察可發現，該類企業不僅於核心議題（如員工流動、訓練、薪酬等）有穩定揭露，亦延伸至部分較為延伸或選擇性較高之議題，反映其在揭露策略上較具全面性。

中段企業（多數集中於 14 至 15 類）則呈現出「基礎議題已普遍涵蓋，但延伸議題揭露程度不一」之特徵。此類企業大致已建立基本揭露框架，惟在部分子議題（如少數群體平權、承攬商管理或健康管理措施）上仍存在選擇性揭露情形，顯示其揭露行為較偏向回應制度性或外部要求較明確之項目，而非全面鋪陳各類議題。相較之下，揭露廣度較低之企業（如旺宏與矽統）則呈現出議題涵蓋範圍明顯受限之現象，揭露內容多集中於少數核心人力資源管理面向，對於多元性較高或屬延伸性質之議題涉入程度有限。其中，矽統僅涵蓋 3 類子議題，顯示其在人力資源相關資訊揭露上仍處於相對初步階段，尚未形成完整之揭露結構。

若進一步對照揭露深度分析結果，可發現揭露廣度與揭露深度之間呈現一定程度之正向關聯。整體而言，揭露廣度較高之企業，亦傾向於在個別議題中提供較多指標與細節，顯示其不僅在議題覆蓋上較為完整，在資訊揭露品質上亦相對成熟；反之，揭露廣度較低之企業，多半在單一議題之揭露深度上亦較為有限。此一結果顯示，企業在人力資源永續揭露上，廣度與深度之發展可能並非獨立，而是受到整體揭露策略與資源配置共同影響。

3. 產業整體揭露廣度概況

由於本研究之揭露廣度滿分為 20 類，代表企業是否涵蓋本研究所設定之全部子分類議題。而根據樣本企業之實際分布結果可發現，多數企業集中於 13 至 18 類之間，僅少數企業低於 13 類。基於此，本研究並未採用等距分組，而是依據樣本企業實際得分分布進行級距劃分，以呈現企業間揭露廣度之相對差異。樣本企業之揭露廣度得分一樣分為四個級距：

I. 高廣度揭露群 (≥ 17)

表此類企業揭露內容已涵蓋大多數子分類議題。

II. 中高廣度揭露群 (≥ 15) 與中低廣度揭露群 (≥ 14)

具備相對完整之議題涵蓋，但依據程度不同仍有部分延伸議題未被納入。



III. 低廣度揭露群 (<13)

表示其揭露範圍相對集中於少數議題，整體涵蓋程度較為有限。

表六、揭露廣度分析結果集整表

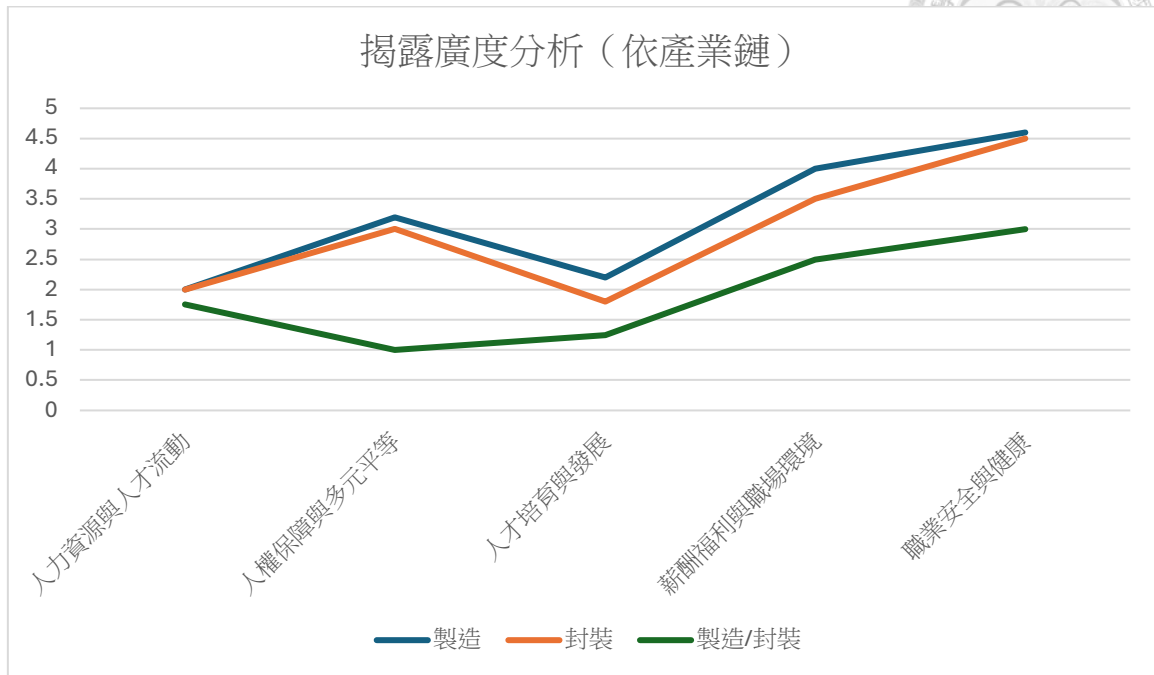
級距	公司（依揭露廣度得分結果）	產業鏈位置	規模
≥ 17	力成、台積電、華邦電、南亞科	製造 (3) 封裝 (1)	高 (1) 次高 (2) 中 (1) 低 (0)
≥ 15	聯電、順德、京元、景碩、華東、南茂	製造 (1) 封裝 (5)	高 (1) 次高 (3) 中 (1) 低 (0)
≥ 13	華泰、超豐、京鼎、宇瞻、台亞、日月光	製造 (0) 封裝 (5) 封裝/製造 (1)	高 (1) 次高 (0) 中 (2) 低 (3)
< 13	台勝科、界霖、旺宏、矽統	製造 (0) 封裝 (1) 封裝/製造 (3)	高 (0) 次高 (0) 中 (2) 低 (2)

如表六所示，從產業鏈位置觀察，揭露廣度之分布呈現差異。高揭露廣度級距中，製造企業占比仍然較高，顯示其在議題涵蓋範圍上相對完整；而中間級距則以封裝企業為主要組成，且分布較為集中；至於最低級距 (<13 類) 中，則以製造／封裝混合型企業為主，顯示其在多數子分類議題中尚未形成全面性揭露。整體而言，不同產業鏈位置之企業在議題涵蓋程度上呈現一定程度之差異。

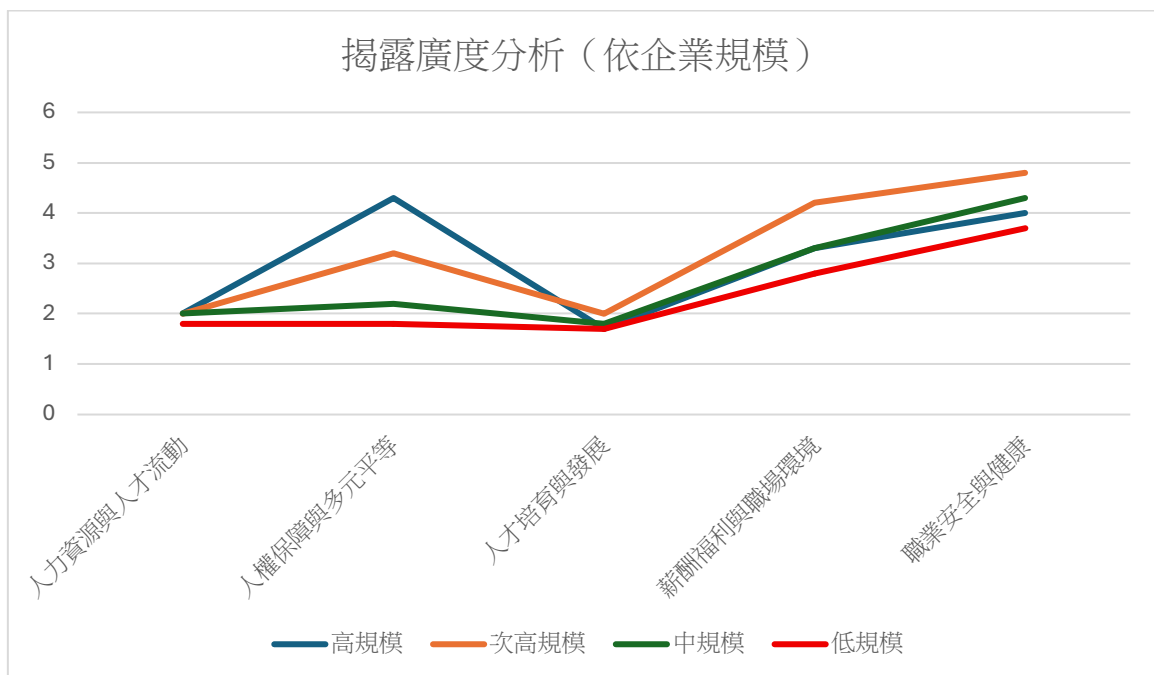
另一方面，從公司規模觀察揭露廣度之分布，亦可發現高規模與次高規模企業多集中於高揭露廣度與中高級距，顯示其在議題涵蓋上較具完整性；中規模與低規模企業則多分布於中低級距，且較少出現在最高級距中。此一結果顯示，企業規模與揭露廣度之間存在一定程度之關聯性，規模較大之企業在議題涵蓋上普遍較為全面，而規模較小之企業則較集中於部分核心議題之揭露。

綜合而言，揭露廣度之結果顯示，樣本企業在議題涵蓋上呈現由少數高廣度企業與多數中等廣度企業所構成之分布結構，且不同產業鏈位置與公司規模下，皆呈現相對一致之高低分布趨勢。

圖五、樣本企業揭露廣度分布（依產業鏈）



圖六、樣本企業揭露廣度分布（依企業規模）



觀察樣本企業在各個核心主題中的揭露廣度結果（圖五、六），能進一步發現以下趨勢：

在產業鏈位置方面，揭露廣度於不同類型企業間呈現出一定程度之差異。整體而言，製造與封裝企業在多數核心主題上之揭露廣度表現相近，並未出現顯著落差，顯示半導體產業於S構面議題之基本涵蓋範圍已具一致性。然而，進一步觀察可發現，製造企業在「薪酬福利與職場環境」議題上之揭露相對較為完整，而封裝企業則在「人權保障與多元平等」、「職業安全與健康」等相關議題上縮短差距，反映不同價值鏈位置下企業所面對之管理重點與外部要求存在差異。相較之下，製造／封裝混合型企業在各構面之揭露廣度普遍偏低，顯示其在議題涵蓋上仍較為集中，尚未形成完整之揭露架構。

而在企業規模方面，揭露廣度則呈現較為明顯之階層性差異。規模愈大之企業，其在多數核心主題上的揭露廣度亦相對較高，尤其在「人權保障與多元平等」及「薪酬福利與職場環境」等議題中，高規模與次高規模企業明顯涵蓋較多子分類內容，顯示其在制度建置與資訊揭露完整性上具備較高成熟度。相對而言，中小規模企業之揭露範圍則較為集中，多數仍聚焦於基本且必要之揭露項目，於部分延伸性或進階議題之涵蓋程度相對有限。此一結果顯示，企業規模對揭露廣度具有一定影響，特別是在議題覆蓋範圍的完整性上，但其影響程度仍低於揭露深度所呈現之差異幅度。

最後，如表七所示，進一步比較各企業之揭露廣度與揭露深度結果可發現，兩者整體呈現正向關聯趨勢。廣度較高之企業，其揭露深度通常亦相對較高，不僅涵蓋較多社會構面子議題，同時亦於各議題下揭露較多量化指標與具體資訊。相對地，揭露廣度較低之企業，其揭露深度亦多偏低，於議題涵蓋範圍與指標揭露數量上皆相對有限。

此結果顯示，企業在社會構面揭露上並非僅擴大議題涵蓋範圍，而是傾向同步增加各議題之揭露內容與資訊細緻程度，反映揭露廣度與揭露深度之間具有一定程度的正向關聯。然而，部分企業仍存在廣度與深度表現不一致之情形，例如超豐、京元及宇瞻等企業，顯示企業之揭露策略與資訊呈現方式亦可能影響最終揭露結果。

表七、樣本企業揭露深廣度差異比較表

公司名稱	揭露深度 分數	揭露深度 層級	揭露廣度 分數	揭露廣度 層級
聯華電子股份有限公司	47	中高	15	中高
華泰電子股份有限公司	41	中低	14	中低
台灣積體電路製造股份有限公司	62	高	18	高
旺宏電子股份有限公司	34	低	10	低
台亞半導體股份有限公司	40	中低	13	中低
華邦電子股份有限公司	59	高	18	高
順德工業股份有限公司	45	中高	15	中高
矽統科技股份有限公司	9	低	3	低
南亞科技股份有限公司	60	高	17	高
超豐電子股份有限公司	27	低	14	中低
京元電子股份有限公司	38	中低	15	中高
景碩科技股份有限公司	45	中高	15	中高
京鼎精密科技股份有限公司	37	中低	14	中低
台塑勝高科技股份有限公司	29	低	12	低
日月光投資控股股份有限公司	39	中低	13	中低
界霖科技股份有限公司	32	低	12	低
力成科技股份有限公司	65	高	18	高
華東科技股份有限公司	37	中低	15	中高
南茂科技股份有限公司	49	中高	15	中高
宇瞻科技股份有限公司	47	中高	14	中低

三、半導體產業之揭露缺口

透過分析 20 家樣本企業永續報告書所涵蓋之五大核心主題、20 項子類別以及細項揭露指標，本研究發現半導體產業在報告書的揭露議題中存在部分揭露不足與發展不均之現象：

1. 揭露指標數量偏少且覆蓋率低之議題

部分子分類議題之對應指標數量偏少，且僅有少數企業進行揭露（如下表所示），顯示該類議題於半導體產業中尚未形成穩定之揭露架構。此類議題多屬較

難量化或制度化程度較低之面向，企業多以概念性或零星措施進行說明，缺乏一致之指標設計與揭露方式，導致整體資訊呈現分散且可比性不足。未來若欲提升S構面揭露之完整性，仍有賴於針對此類議題發展更具體且可量化之揭露指標，以促進企業間資訊之一致性與可比較性。

表八、子類別揭露缺口摘要表

子類別	對應指標總數量	備註
少數群體與外籍員工平權措施	2	僅少部分公司提出協助外籍移工之適應協助（台積電、日月光、力成），針對少數群體（原住民）之揭露也僅限於員工人數，僅華邦電提出文化特別假期
人權保障	2	不到半數企業有揭露人權相關訓練狀況與申訴案件，制度化程度低
員工敬業度	1	僅揭露敬業度與滿意度問卷回收/涵蓋率，內容局限
輪調歷練	1	除台積電、華邦電、南亞科與宇瞻外，其餘企業未提及相關制度推動措施
假期	2	大部分公司對於假期相關資訊無數據相關描述
工時	2	未進一步揭露如平均工時、加班控管及彈性工時等相關細項內容

*不包含傷病統計（由於個案企業皆針對此單一子類別撰寫多元內容）

2. 企業間揭露程度差異顯著之議題

根據前述研究內容可發現，樣本企業之揭露深度存在顯著差距。表八為排除揭露程度極低之個案（矽統）後，將指標數量相對豐富之子分類議題所歸納出之細緻程度差異。結果顯示，即使排除極端值後，此一落差仍然存在，顯示企業在相同議題下之揭露能力並不一致。

進一步觀察可發現，高揭露企業多能提供多面向且具延伸性的指標內容，而低揭露企業則多僅呈現基礎或概括性資訊，反映其在內部管理成熟度與資料整合能力上的差距。此一現象顯示，半導體產業在相關議題上雖已逐步建立揭露基礎，然在揭露一致性與資訊可比性方面仍有待強化，未來仍需透過揭露準則或產業共識之建立，以縮小企業間差距並提升整體資訊品質。

表九、子類別揭露深度差距摘要表

子類別	最大深度	最小深度	差異值	備註
員工流動	15 (南亞科)	4 (超豐)	11	企業雖普遍揭露新進與離職人數人口概要狀況，然而在內轉率、晉升率、留任率相關數值上之揭露狀況差距大
員工訓練	8 (南亞科)	2 (超豐)	6	多數企業揭露總體訓練概況以及特定主題相關訓練，低揭露企業則以特定訓練敘述為主，未有總體歸納平均數據
薪酬	5 (華邦電)	0 (日月光)	5	涉及薪資總額、平均數、中位數、基本薪資比率等內容，低深度企業僅採用敘事方式揭露
健康管理	6 (台積電)	0 (台勝科)	6	表現兩極，高揭露企業提供多元化揭露內容與成效，低揭露企業則無相關描述

第五章、結論與建議

第一節、研究發現



本研究透過系統性內容分析方法，針對台灣半導體製造業上市公司之永續報告書進行檢視，聚焦於 ESG 社會（S）構面之揭露內容，並從揭露架構、揭露深度與揭露廣度三個面向進行比較分析。透過建立一致之分類架構，本研究得以梳理產業內各企業於 S 構面揭露之共通性與差異性，並進一步探討影響其揭露表現之可能因素。其中，本研究之主要發現包涵：

一、半導體產業 S 構面揭露已出現部分量化共通指標，然而整體標準化程度仍具差異

經本研究之內容分析結果可發現，半導體產業於 ESG 社會（S）構面之揭露已逐步發展出一定程度之量化基礎，部分子分類議題中已出現多數企業採用相似揭露指標之情形，顯示產業內部逐漸形成共通之揭露模式。然而，此一趨勢主要集中於少數具高度可量化特性的議題，其餘多數議題之揭露方式仍呈現明顯差異。

下方表格為經整理後之典範指標摘要表，彙整 20 項子類別中，樣本企業間具有高度共通性之揭露指標內容。而在典範指標之判定上，本研究並未採用「所有樣本企業皆揭露」作為標準，而是以 20 家樣本企業中有超過 16 家（即達八成以上）皆揭露之指標作為典範指標之判定門檻。此一設定主要考量本研究樣本數量較多，且企業間揭露程度差異顯著，部分企業（如揭露項目極少之矽統）可能對整體判定結果產生過度影響。故透過設定相對多數門檻，可在維持代表性之同時，避免極端值干擾，較能反映產業中已具共識之揭露內容。

而根據結果顯示，「員工人口分布」以及「員工流動」兩項子類別之典範指標數量為最多且最密集，企業普遍揭露新進與離職人員數量，並進一步依性別、年齡等維度進行拆分，形成相對一致之揭露架構。此外，「員工訓練」議題亦呈現一定程度之標準化趨勢，多數企業皆揭露訓練總時數、平均訓練時數，並依員工屬性進行分類，顯示此類指標已成為產業中普遍採用之揭露內容。



另一方面，在「性別平權」、「生育相關福利」、「傷病情形」與「職場安全衛生」等議題中，亦可觀察到部分共通指標之存在。例如兩性薪酬差距、育嬰留停使用情形、失能傷害頻率與嚴重率，以及職業安全衛生教育訓練等，均為多數企業共同揭露之核心項目。雖然其典範指標數量皆僅有一項，但其內容具備一定程度之揭露標準化特徵，例如傷病情形多以失能傷害頻率（FR）、嚴重率（SR）、公傷及職業病等指標呈現，生育相關福利則普遍以育嬰留停申請人數、復職率與留任率等指標進行揭露，顯示企業間在指標選擇與揭露方式上具有高度一致性。

表十、典範指標摘要表

子類別	典範指標（八成公司共同採用）	指標總數	典範指標數量
員工人口分布	全體員工分布、全體員工分布（依性別）、全體員工分布（依年齡）、全體員工分布（依雇用類型）、身心障礙員工	11	5
員工流動	新進人員統計、新進人員統計（依性別）、新進人員統計（依年齡）、離職人員統計、離職人員統計（依性別）、離職人員統計（依年齡）	17	6
性別平權	兩性薪酬差異	4	1
員工訓練	總體訓練時數、總體訓練時數（依性別）、總體訓練時數（依職位）	10	3
生育相關福利	育嬰留職停薪	5	1
傷病情形	傷病統計	1	1
職場安全衛生	職業安全衛生教育訓練	3	1

整體而言，本研究架構下之 20 項人力永續子分類議題中，共有 7 項可觀察到具高度共通性之揭露指標，顯示半導體產業於部分議題已逐步形成相對穩定之揭露模式。相較於其他子分類仍呈現多元且分散之揭露方式，此類已具典範性之指標反映企業在特定議題上已建立共通之揭露語言與衡量基礎。

進一步觀察可發現，具共通性的揭露指標多集中於高度可量化且資料取得相對成熟之議題，例如員工流動、員工人口結構與訓練投入等，其指標多屬企業日常營運管理中長期追蹤之項目，具備明確定義與簡易計算邏輯，且多為人力資源或職業安全管理系統既有之統計資料。此外，如傷病情形與生育相關福利等議題，雖典範指標數量有限，但其揭露內容在指標選擇與計算方式上仍呈現高度一致，顯示該類議題已發展出產業內相對成熟之揭露慣例。

另一方面，尚未形成典範指標之子分類，多集中於較難量化或涉及主觀評估之議題，例如組織文化、員工關係或部分人權相關措施等，其揭露內容多以質性敘述為主，缺乏一致之衡量方式，導致企業間資訊可比性較低。此一現象亦反映半導體產業在S構面揭露上，仍存在由「可量化指標導向」向「整合性揭露」過渡之發展階段。

二、企業間之揭露差異不僅體現在議題選擇上，也反映於數據化揭露程度之不同

本研究發現，部分企業雖於社會（S）構面中涵蓋大量文字敘述與制度說明，然而在具體數據、量化成果或長期追蹤指標之揭露上卻相對保守，導致整體揭露深度評分偏低。

反映此現象最明顯之企業為日月光。該企業在分類上屬於高規模企業，理應具備較高之揭露成熟度與完整性，且於永續報告書中亦確實花費大量篇幅說明社會構面相關議題。然而其在人才培育、薪酬福利以及職業安全等相關主題上卻多以如「提供具競爭力的整體薪酬，整體薪酬包含本薪、津貼、員工現金獎金等。」（日月光，2024）內容呈現，缺乏具體數值、年度比較或績效成果，使其揭露內容較偏向政策宣示與制度描述，而非具可驗證性之資訊揭露。此現象顯示，目前半導體企業於S構面揭露上，仍存在「敘述型揭露」與「數據型揭露」之差異。

進一步觀察可發現，此類「敘述型揭露」多集中於較難量化或涉及敏感管理資訊之議題，例如薪酬制度、健康管理措施、人才培育成效與員工關懷方案等。相較於員工人數、訓練時數或離職率等具明確計算方式之指標，部分企業較傾向

以制度說明、政策方向或活動成果進行呈現，而未進一步揭露實際執行情形、投入資源或長期成效。此現象反映目前部分半導體企業在 S 構面資訊揭露上，仍偏向以形象傳達與制度宣示為主，而非建立完整且可追蹤之量化揭露架構。

三、企業規模對揭露完整性具有較明顯影響，而產業鏈位置則主要影響議題配置方向

本研究結果顯示，相較於產業鏈位置之差異，企業規模對於 S 構面揭露深度與廣度之影響更為明顯。整體而言，高規模與次高規模企業普遍具有較完整之揭露架構，不僅涵蓋較多子議題，亦較常提供量化指標、年度比較與細項分類資訊。例如台積電、聯電與華邦電等大型製造企業，以及力成、景碩等大型封裝企業，皆於員工流動、人才培育、薪酬福利及職業安全等主題中建立較完整之數據揭露模式，反映大型企業在 ESG 治理制度、跨部門資料整合能力與永續報告編製資源上具有較高成熟度。

此外，高規模企業通常亦處於國際供應鏈核心位置，需回應國際客戶、投資人與外部稽核機制對 ESG 資訊透明化之要求，因此較傾向建立制度化、可追蹤且具一致性的揭露架構。例如台積電除揭露基礎訓練與職安數據外，亦進一步揭露分職級、分性別之訓練時數與人才結構資訊；力成與南亞科則在人才培育與健康管理議題中提供較多延伸性指標，顯示其揭露不僅停留於法規遵循，而已逐步朝向績效管理與長期追蹤方向發展

另一方面，產業鏈位置則較明顯影響企業之議題配置方向。製造企業普遍較重視職業安全、健康管理與制度化治理等議題，其揭露內容亦較偏向標準化與風險管理導向；封裝企業則因產業特性相對勞動密集，較常聚焦於人權、員工訓練、員工流動、勞動管理等人力資源相關議題。例如力成、南茂與京元等封裝企業，皆於人才培育中揭露較多細項指標。然而，本研究亦發現，即便位於相同產業鏈位置，企業間揭露程度仍存在明顯差異，例如同屬封裝產業之日月光與超豐，其揭露深度與數據化程度即明顯低於力成與南茂。此結果顯示，價值鏈位置雖會影響企業所重視之揭露主題，但揭露完整性仍主要受到企業規模、治理成熟度與揭露策略等因素所影響。

第二節、研究問題回應



基於前述分析結果，本節將依序回應本研究所提出之研究問題，從產業整體揭露特性出發，說明企業間在揭露內容與形式上的異同，並進一步檢視公司規模與價值鏈位置對揭露結構之影響，以歸納出台灣半導體產業於 S 構面揭露之整體發展趨勢。

一、整體揭露架構之共通性與差異性

在整體揭露架構方面，根據本研究對 20 間台灣半導體製造業上市公司永續報告書之內容分析結果，各企業於 ESG 社會（S）構面之揭露已呈現出一定程度之共通性。多數企業皆依循國際揭露準則（如 GRI）進行內容編排，並圍繞「員工」、「職業安全與健康」、「人才發展」及「人權與多元共融」等核心議題進行架構設計。此顯示在制度規範與利害關係人壓力之影響下，產業內企業已逐步形成相對一致之揭露主題分類。

進一步從架構層級觀察，多數企業之 S 構面揭露大致可區分為「主題—子議題—指標」三層結構，且在部分子議題中已出現高度一致之揭露項目，例如員工訓練、職業安全指標等，顯示企業之揭露實務已逐漸形成共同語言與典範（benchmark）。此現象與既有研究指出部分 ESG 子類別已出現標準化揭露趨勢之發現相符。

然而，在整體共通架構之下，各企業在細部分類與議題配置上仍呈現顯著差異。首先，在議題整合程度上，部分企業傾向採取整合式架構，將多項員工相關議題集中於單一章節說明；相對而言，亦有企業將議題進行細緻拆分，以多層級分類呈現其管理措施與績效成果。其次，在子議題之延伸內容上，各公司亦展現不同揭露策略，例如在員工福利或人才管理等議題中，除核心指標外，各企業所補充之制度或措施內容差異明顯，反映企業在資源配置與策略重點上的不同選擇。

整體而言，台灣半導體產業於 S 構面之揭露呈現出「主題架構趨於一致、細部內容高度分化」之特徵。一方面，國際準則與制度規範促使企業在揭露形式上逐步收斂；另一方面，由於社會構面本身議題範圍廣泛且具高度彈性，不同企業仍得以依其規模、資源與產業角色，調整揭露內容之深度與重點，進而形成差異化之揭露模式。

二、公司規模與揭露程度之關聯性

根據本研究結果顯示，公司規模與揭露程度之間呈現一定程度之正向關聯。高規模企業中，台積電同時位居揭露廣度最高群（18 類）與揭露深度最高群（65 項），聯電亦達 15 類揭露廣度與 46 項揭露深度，顯示規模較大之企業通常具備較完整之揭露架構與較高之資訊細緻程度。

次高規模企業亦普遍呈現較佳揭露表現。力成與華邦電分別達 18 類揭露廣度，且揭露深度分別為 65 項與 59 項，顯示其雖非最大規模企業，但在人力資源與 S 構面資訊揭露上已具備高度系統化之特徵。景碩、京元與南茂則多落於中高程度，顯示次高規模企業整體上仍具有相對完整之揭露能力。

然而，本研究亦發現公司規模並非唯一決定因素。日月光雖被歸為高規模企業，但其揭露廣度僅為 13 類，揭露深度為 39 項，並未明顯高於部分中規模或低規模企業；相反地，南亞科雖屬中規模企業，卻具有 17 類揭露廣度與 60 項揭露深度，表現接近高揭露企業。此外，宇瞻雖屬低規模企業，其揭露深度亦達 47 項，這一定程度顯示了利害關係人壓力的傳遞效應，當低規模供應商高度嵌入於國際級或制度要求極高之跨國大廠價值鏈時，其承受的外部合法性壓力會迫使其必須深化揭露。另外，若企業能將永續治理內化於成熟的內部機制中，即使在組織資源有限的硬性限制下，亦能有效克服資源劣勢，產出高品質的社會構面資訊。

相較之下，低規模企業整體揭露表現較為分散。矽統之揭露廣度僅 3 類、揭露深度 9 項，明顯低於其他樣本企業，顯示其 S 構面揭露仍處於較初步階段；但同屬低規模群之華泰、華東、宇瞻與台亞，則分別在廣度或深度上具有一定表

現，說明低規模企業之揭露程度並非必然偏低，而是受到企業揭露策略、報告書撰寫成熟度與議題重視程度等因素影響。

整體研究結果顯示，公司規模對半導體企業 S 構面揭露程度具有一定影響，尤其在高規模與次高規模企業中，較常出現高廣度與高深度之揭露表現。然而，規模與揭露程度之間並非完全線性關係，南亞科、宇瞻等案例顯示，企業內部治理制度、永續揭露意識與報告書編製成熟度，亦可能使中低規模企業展現較高揭露程度。因此，公司規模可視為影響揭露程度的重要條件之一，但並非唯一解釋因素。

三、產業鏈位置對揭露策略之影響

本研究進一步依據企業於半導體產業產業鏈中的功能位置，將樣本區分為製造、封裝及製造／封裝混合三類，並比較其於 S 構面之揭露表現。整體而言，產業鏈位置對於企業揭露「內容重點與策略配置」具有一定影響，但對揭露程度之高低影響相對有限。

在製造端企業中，如台積電、聯電與華邦電，普遍呈現較高揭露廣度與深度，其揭露內容亦較具系統性，涵蓋人權保障、職業安全、人才培育等多項議題，並多以制度化與標準化指標呈現。此一現象與製造業本身之產業特性密切相關。半導體製造屬高度資本與技術密集產業，企業多深度參與國際供應鏈體系，需同時回應國際客戶、投資人與監管機構之要求，因而傾向建構完整且一致之永續揭露架構，以提升資訊透明度與可比較性。

相較之下，封裝企業之揭露內容則較集中於人力資源與勞動相關議題，包括員工訓練、職業安全與健康管理等面向，反映其產業特性較偏向勞動密集，員工人數規模較大，第一線作業人員比例較高。此外，封裝企業多位於供應鏈中下游，需配合上游製造企業及國際客戶之供應鏈管理要求（如責任商業聯盟相關規範），使其在人力與職安議題上投入較多揭露。然而，封裝企業內部揭露表現差異較大，例如力成與南茂於揭露深度上表現突出，但日月光與超豐則在廣度或深

度上相對有限，顯示即使處於相同產業鏈位置，企業之揭露策略仍存在顯著差異。

至於製造／封裝混合型企業，整體揭露程度相對較低，且揭露內容較為分散，部分企業於多項子議題中未有具體指標呈現。此類企業多同時涉足不同製程環節，業務結構相對多元，但規模普遍較小，使其在資源配置與揭露策略上較難形成明確主軸，亦反映其在永續資訊整合與制度化管理上仍處於發展階段。

綜合而言，產業鏈位置確實影響企業在 S 構面揭露之議題選擇與內容配置，製造企業偏向制度化與全面性揭露，封裝企業則較強調勞動與職安議題；然而，揭露程度之高低仍受到公司規模、治理成熟度及揭露策略等因素共同影響。換言之，價值鏈位置主要影響「揭露內容如何配置」，而非單純決定「揭露多寡」，顯示企業永續揭露行為係多重因素交互作用之結果。

第三節、研究限制與未來研究建議

一、以量化指標作為納入標準之限制

本研究在揭露內容之判定上，是以企業是否提供具體量化數據作為納入分析之依據，以確保不同企業間揭露內容之可比性。然而，此一操作方式亦可能導致部分以質性敘述為主之揭露內容未能被完整反映，尤其社會相關議題許多具備一定程度之敘事性。例如，部分企業雖對相關議題有詳盡說明，但未輔以具體數據佐證，因而未被納入統計分析之範圍。以健康管理相關活動為例，日月光於報告書中即提供豐富之活動說明與措施內容，然而因缺乏對應之量化指標，未能反映於本研究之指標統計結果中，也因而大幅影響其整體分數表現。因此，本研究之分析結果較偏重於企業之「量化揭露能力」，而對於偏重質性揭露之企業或議題，可能產生低估其實際投入程度之情形。

二、半導體產業內部企業特性差異尚未被完全反映

本研究雖已依企業於產業供應鏈中的功能位置進行分類，但半導體產業內部仍具有高度異質性，不同企業之商業模式、客戶結構與供應鏈角色皆可能影響其ESG揭露策略。故僅以產業鏈位置作為分類基礎，仍難以完全反映企業間實際之經營特性與揭露差異。

三、現行揭露分析架構對資訊品質之反映仍有限

本研究主要聚焦於揭露內容之廣度與深度（是否揭露特定議題、是否提供量化數據及指標數量等），尚未進一步評估揭露資訊之品質、可比較性與可信度。例如企業是否提供長期趨勢比較、是否揭露改善目標、是否經第三方驗證等，皆可能影響永續資訊之決策價值。

四、敘述型揭露傾向尚未進一步實證化

本研究在分析過程中觀察到，部分企業於社會（S）構面中傾向採用較多敘述性內容說明其制度、政策與推動措施，而非以具體數據或量化指標呈現。然而，此一現象主要來自文本整理過程中的觀察，尚未進一步建立明確之判定標準或量化方法加以驗證。例如，本研究未針對敘述性文字篇幅、量化數據比例、指標密度或敘述與數據之搭配程度進行系統性計算，因此無法更精確判斷不同企業是否確實存在「敘述型揭露偏好」。此為本研究在揭露形式分析上的限制。

五、樣本分布之限制

本研究以台灣半導體製造業上市公司為研究對象，並依研究條件篩選樣本。然而，由於符合條件之製造類企業數量相對有限，且被納入分析之製造企業多屬產業內規模較大之代表性公司，因此在比較不同價值鏈位置企業之揭露差異時，可能同時受到企業規模因素之影響，導致無法完全排除樣本分布所造成之潛在偏誤。

六、未來研究建議

為因應上述研究限制，未來研究可進一步強化對企業揭露形式與資訊品質之分析。本研究主要以揭露項目與量化指標作為比較基礎，然而研究過程中亦觀察

到，部分企業傾向以大量敘述性內容呈現其 ESG 社會構面作為，而非透過具體數據進行揭露。未來研究可嘗試建立更細緻之分析方式，例如比較敘述性文字與量化數據之比例、指標密度、年度趨勢資訊或數據可驗證程度等，以更全面反映企業揭露品質與資訊透明程度，並進一步探討不同揭露形式對外部利害關係人資訊使用之影響。

此外，本研究雖已依據半導體產業價值鏈位置與企業規模進行分析，但半導體產業內部仍具有高度異質性，不同企業在產品類型、客戶結構、國際供應鏈角色與經營模式上皆可能影響其 ESG 揭露策略。未來研究可擴大分析規模，進一步細分產業類型，例如區分晶圓代工、記憶體、封測、設備或材料相關企業，或進一步納入企業治理、海外布局及國際客戶結構等因素進行交叉分析，以更深入探討影響半導體企業 S 構面揭露差異之原因。

參考文獻

中文

- 力成科技股份有限公司 (Powertech Technology Inc.) . (2025) 。永續報告書 2024 。<https://www.pti.com.tw/zh/csr/interactive/download>
- 日月光投資控股股份有限公司 (ASE Technology Holding Co., Ltd) . (2025) 。永續報告書 2024 。<https://www.aseglobal.com/ch/csr/csr-download/>
- 台亞半導體股份有限公司 (Taiwan-Asia Semiconductor Corp.) . (2025) 。永續報告書 2024 。<https://www.tascsemi.com/corporate-sustainability/sustainability-report/corporate-sustainability-report-of-the-year/>
- 台塑勝高科技股份有限公司 (Formosa Sumco Technology Corp.) . (2025) 。永續報告書 2024 。
https://www.fstech.com.tw/FPC_Fstech_Web/fst_csr.html?page=pills-resource
- 台灣積體電路製造股份有限公司 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd) . (2025) 。永續報告書 2024 。<https://esg.tsmc.com/zh-Hant/file/public/2024-TSMC-Sustainability-Report-c.pdf>
- 宇瞻科技股份有限公司 (Apacer Technology Inc.) . (2025) 。永續報告書 2024 。
<https://www.apacer.com/zh-tw/normaldownload/download-report>
- 京元電子股份有限公司 (King Yuan ELECTRONICS CO., LTD.) . (2025) 。永續報告書 2024 。<https://www.kyec.com.tw/zh-tw/Csr/csrdownload>
- 京鼎精密科技股份有限公司 (Foxsemicon Integrated Technology Inc.) . (2025) 。永續報告書 2024 。https://www.foxsemicon.com/zh-tw/csr_report.aspx
- 旺宏電子股份有限公司 (Macronix International Co., Ltd) . (2025) 。永續報告書 2024 。<https://www.mxix.com.tw/zh-tw/about/ESG/Pages/CSR-report.aspx>
- 矽統科技股份有限公司 (Silicon Integrated Systems Corp.) . (2025) 。永續報告書 2024 。<https://www.sis.com/zh-tw/Investory/GovernancePolicy>



南亞科技股份有限公司 (Nanya Technology Corp.) . (2025) 。永續報告書
2024 。https://www.nanya.com/ESG/tw/csr_report

南茂科技股份有限公司 (ChipMOS TECHNOLOGIES INC.) . (2025) 。永續報告書
2024 。<https://www.chipmos.com/chinese/csr/report.aspx>

界霖科技股份有限公司 (Jih Lin Technology Co., Ltd.) . (2025) 。永續報告書
2024 。https://www.jihlin.com.tw/esg_report

超豐電子股份有限公司 (Greatek Electronics Inc.) . (2025) 。永續報告書 2024 。
https://www.greatek.com.tw/files/business4/ESG%20report%20Cn_2024.pdf

華邦電子股份有限公司 (Winbond Electronics Corp.) . (2025) 。永續報告書
2024 。<https://esg.winbond.com/resource/download>

華東科技股份有限公司 (Walton Advanced Engineering, Inc.) . (2025) 。永續報告書 2024 。
https://www.walton.com.tw/modules.php?name=esg&file=rpt_esg_reports&lang=zh-TW

華泰電子股份有限公司 (Orient Semiconductor Electronics, Ltd) . (2025) 。永續報告書 2024 。
<https://esg.ose.com.tw/%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E4%B8%8B%E8%BC%89/>

景碩科技股份有限公司 (Kingsus Interconnect Technology Corp.) . (2025) 。永續報告書 2024 。
<https://www.kinsus.com.tw/zh-TW/Download/csr-report>

順德工業股份有限公司 (SDI Corp.) . (2025) 。永續報告書 2024 。
<https://www.sdi.com.tw/csr.php>

聯華電子股份有限公司 (United Microelectronics Corp.) . (2025) 。永續報告書
2024 。https://www.umc.com/zh-TW/Download/corporate_sustainability_reports

林映均、蔡奉真 (2025)。〈人權、供應鏈與貿易：美國與歐盟的供應鏈貿易規範發展與地緣政治經濟意義〉。《經貿法訊》，第 346 期。

<https://tradelaw.nccu.edu.tw/epaper/no346/3.pdf>

金融監督管理委員會。(2025)。〈金管會提醒今(114)年8月底前全體上市櫃公司均應申報永續報告書〉。金融監督管理委員會全球資訊網。

https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?dataserno=202507030002&dtable=News&id=96&mcustomize=news_view.jsp&parentpath=0,2

陳華羚 (2025)。以人力資源管理觀點探討 ESG 社會構面揭露框架——以四家金融業公司為例 (碩士論文，國立臺灣大學)。國立台灣大學博碩士論文典藏系統。<https://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/98046>

劉念琪、戴曉惠、鄭明哲 (2025)。ESG 評鑑中的員工人權治理：人權盡職調查觀點。人力資源管理學報，25(2)，83–111。

[https://doi.org/10.6147/JHRM.202512_25\(2\).0003](https://doi.org/10.6147/JHRM.202512_25(2).0003)

KPMG 安侯建業。(2024)。2024 年全球企業永續大調查。

<https://kpmg.com/tw/zh/home/insights/2022/05/esg-report-and-assurance-insight.html>

KPMG 安侯建業。(2023)。永續報告，您準備好了嗎？：永續報告現況與趨勢展望。<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tw/pdf/2023/09/are-you-ready-for-esg-reporting.pdf>

ISO 顧問職人。【ISSB 專題】氣候管理將進入新篇章：TCFD 與 IFRS S2 差異分析。<https://isoleader.blogspot.com/2024/11/issbtcfd-ifrs-s2.html>

英文

- Abbott, W. F., & Monsen, R. J. (1979). On the measurement of corporate social responsibility: Self-reported disclosures as a method of measuring corporate social involvement. *Academy of Management Journal*, 22(3), 501–515.
<https://doi.org/10.5465/255740>
- Albu, O. B., & Flyverbom, M. (2016). Organizational transparency: Conceptualizations, conditions, and consequences. *Business & Society*, 58(2), 268–297._
<https://doi.org/10.1177/0007650316659851>
- Awa, H. O., Etim, W., & Ogbonda, E. (2024). Stakeholders, stakeholder theory and corporate social responsibility (CSR). *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 9, 11. <https://doi.org/10.1186/s40991-024-00094-y>
- Baid, V., & Jayaraman, V. (2022). Amplifying and promoting the “S” in ESG investing: The case for social responsibility in supply chain financing. *Managerial Finance*, 48(8), 1279–1297. <https://doi.org/10.1108/MF-12-2021-0588>
- Berelson, B. (1952). *Content analysis in communication research*.
<https://archive.org/details/contentanalysisi0000bern>
- Billio, M., Costola, M., Hristova, I., Latino, C., & Pelizzon, L. (2021). Inside the ESG ratings: (Dis)agreement and performance. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. <https://doi.org/10.1002/csr.2177>
- Campbell, J. L. (2007). Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility. *Academy of Management Review*, 32(3), 946–967. <https://doi.org/10.5465/amr.2007.25275684>
- Chen-Yuan Tung (2023). Taiwan and the Global Semiconductor Supply Chain. Taipei Representative Office in Singapore. <https://roc-taiwan.org/uploads/sites/86/2023/08/20230824-TAIWAN-AND-THE-GLOBAL-SEMICONDUCTOR-SUPPLY-CHAIN.pdf>
- Clarke, T., & Boersma, M. (2017). The governance of global value chains: Unresolved human rights, environmental and ethical dilemmas in the apple supply

- chain. *Journal of business ethics*, 143(1), 111-131. Principles for Responsible Investment. (n.d.). *Principles for Responsible Investment*. <https://www.unpri.org/>
- De Souza Barbosa, A., da Silva, M. C. B. C., da Silva, L. B., Morioka, S. N., & de Souza, V. F. (2023). Integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria: their impacts on corporate sustainability performance. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 410. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01919-5>
- Distelhorst, Greg, Jens Hainmueller, and Richard M. Locke. *Management Science* Vol. 63, No. 3 (2017): 707-728. <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mnsc.2015.2369>
- Galant, A., & Cadez, S. (2017). Corporate social responsibility and financial performance relationship: A review of measurement approaches. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 30(1), 676–693. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1313122>
- Gereffi, G. (2018). *Global value chains and development: Redefining the contours of 21st century capitalism*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108559423>
- Global Reporting Initiative. (n.d.). GRI standards. <https://www.globalreporting.org/standards/>
- Hess, D. (2019). The transparency trap: Non-financial disclosure and the responsibility of business to respect human rights. *American Business Law Journal*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ablj.12134>
- IFRS Foundation. (n.d.). SASB standards. <https://sasb.ifrs.org/standards/>
- International Organization for Standardization. (2010). ISO 26000:2010 guidance on social responsibility. International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html>
- Locke, Richard M. and Hiram Samel. *Studies in Comparative International Development* Vol. 53, (2018): 1-24. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12116-017-9258-6>

MSCI. (n.d.). *ESG industry materiality map*. <https://www.msci.com/data-and-analytics/sustainability-solutions/esg-industry-materiality-map>

Responsible Business Alliance. (2023). *2023 annual report*.
<https://issuu.com/eiccoalition/docs/rba2023annualreport>

Russo, A., & Perrini, F. (2010). Investigating stakeholder theory and social capital. *Journal of Business Ethics*, 91(2), 207–221. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0079-z>

Schilling-Vacaflor, A. (2021). Integrating human rights and the environment in supply chain regulations. *Sustainability*, 13(17), 9666. <https://doi.org/10.3390/su13179666>

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>

Task Force on Climate-related Financial Disclosures. (2017). Recommendations of the task force on climate-related financial disclosures. Financial Stability Board. <https://www.fsb-tcfd.org>

Varas, A., Varadarajan, R., Palma, R., Goodrich, J., & Yinug, F. (2021). Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era, Boston Consulting Group, Semiconductor Industry Association. <https://www.bcg.com/publications/2021/strengthening-the-global-semiconductor-supply-chain>

Waas, B. (2021). Supporting the autonomous role of the social partners. In D. Vaughan-Whitehead (Ed.), *The new world of work* (pp. 69–109). Edward Elgar Publishing. <https://www.elgaronline.com/edcollchap-oa/edcoll/9781800888043/9781800888043.00008.xml>

Wickert, C., Scherer, A. G., & Spence, L. J. (2016). Walking and talking corporate social responsibility: Implications of firm size and organizational cost. *Journal of Management Studies*, 53(7), 1169–1196. <https://doi.org/10.1111/joms.12209>



附錄



附表一、內容分析編碼表

核心主題分類 第一層	子類別分類 第二層	整合後指標名稱 第三層	整合前指標索引
人力資源與人才 流動	員工人口分布	全體員工分布	全體員工分布
		全體員工分布（依性別）	全體員工分布（依性別）
		全體員工分布（依年齡）	全體員工分布（依年齡）
		全體員工分布（依學歷）	全體員工分布（依學歷）
		全體員工分布（依國籍）	全體員工分布（依國籍）
		全體員工分布（依地區）	全體員工分布（依地區）
		員工職位身分（職務類別）	員工職位身分（職務類別）
		員工職位身分（勞顧合約）	員工職位身分（勞顧合約）
		員工職位身分（依生產類別）	員工職位身分（依生產類別）
		外國籍員工	外國籍員工人數 外國籍員工比例 員工國籍數量
	員工流動	身心障礙員工	身心障礙員工雇用人數 身心障礙員工雇用比例 加權後身心障礙員工人數
		原住民員工	原住民暨少數民族雇用人數 原住民暨少數民族雇用比例
		新進人員統計	新進人員人數 新進率
		新進人員統計（依性別）	新進人員分布（依性別）
		新進人員統計（依年齡）	新進人員分布（依年齡）
		新進人員統計（依身分）	新進人員分布（依身分）
		新進人員統計（依學歷）	新進人員分布（依學歷）
		新進人員統計（依地區）	新進人員分布（依地區）
		離職員工統計	離職人員人數 離職率
		離職人員統計（依性別）	離職人員分布（依性別）
		離職人員統計（依年齡）	離職人員分布（依年齡）
		離職人員統計（依身分）	離職人員分布（依身分）
		離職人員統計（依學歷）	離職人員分布（依學歷）
		離職人員統計（依地區）	離職人員分布（依地區）
		自願離職率	自願離職率
		內轉率	內轉率
		留任率	留任率
		晉升率	晉升率
		招募成本	人均招募成本 總招募費用
	性別平權	女性員工比例（依身分）	女性員工比例（依身分）
		兩性薪酬差異（依身分）	男女薪酬比例 男女整體薪酬比例 男女基本薪資比率 男女標準薪資比

人權保障與多元平等	性別平權		男女最低起薪比 男女平均報酬比例 管理階層男女全薪平均數比率 非管理階層男女全薪平均數比率
		主管性別比例	管理階層女性比例 初階管理階層女性比例 高階管理階層女性比例 女性主管人數 女性主管比例
		女性升遷	女性員工晉升比例
	少數群體及外籍員工平權措施	文化與特別假期	申請原住民族歲時祭儀假人數 申請原住民族歲時祭儀假比例
		協助適應措施	華語訓練補助 全英文數位學習課程堂數 華語課程累積培育人數 外籍勞工在台須知課程時數 移工職前教育訓練場次
	人權保障	人權相關訓練狀況	人權課程完訓率 人權保障訓練（依主題） 人權保障訓練人次 人權保障訓練總訓練時數 人權主題新進人員訓練比例
		申訴案件	申訴案件數量 員工意見反映管道申報件數 性別歧視申訴案件 性騷擾申訴案件 霸凌申訴案件
	勞資溝通	工會參與	參加工會員工人數 參加工會員工比率
		勞資會議	勞資會議次數 勞方出席率 勞方代表人數 資方代表人數
		多元溝通管道	多元溝通管道件數
		員工意見調查	員工意見調查問卷發放數 員工意見調查有效問卷數
	員工敬業度	敬業度與滿意度調查	員工敬業度指數 員工敬業度問卷分數 員工敬業度問卷涵蓋率 員工滿意度
	員工訓練	總體訓練時數	總訓練時數 平均受訓時數 訓練課程參與人次
		總體訓練時數（依性別）	總訓練時數（依性別） 平均受訓時數（依性別） 訓練課程參與人次（依性別）
		總體訓練時數（依雇用類型）	總體訓練時數（依雇用類型） 平均受訓時數（依雇用類型） 訓練課程參與人次（依雇用類型）

人才培育與發展	員工訓練	總體訓練時數（依職位）	總體訓練時數（依職位） 平均受訓時數數（依職位） 訓練課程參與人次數（依職位）
		總體訓練費用	訓練總花費 人均訓練花費 人才發展投入經費
		訓練課程滿意度	訓練課程滿意度
		特定主題訓練實施	專業證照人員訓練人次 專業證照人員訓練時數 特定技能訓練人次 特定技能訓練時數 公司特有訓練活動訓練人次 公司特有訓練活動訓練時數
		數位學習實施	線上課程堂數 線上課程時數 線上課程舉辦梯次 線上課程完訓人次
		新進人員訓練	新進人員訓練人數 新進人員訓練時數
		財務回報	人力資本投資報酬率
	論調歷練（職涯發展）	內部填補	主管職之內部職缺替補率 主管人員的轉職與論調比例 專業人員的轉職與論調比例 職缺由內部員工轉職填補率 處級以上主管進行單位輪調或晉升比率 內部公開職缺之內部員工替補率 發展式論調比例
		績效考核覆蓋率	實際完成考核人數 績效評核完成率 接受定期績效考核人數 接受定期績效考核比例
	績效考核	績效考核覆蓋率（依性別）	實際完成考核人數（依性別） 接受定期績效考核人數（依性別） 接受定期績效考核比例（依性別）
		績效考核覆蓋率（依生產類別）	實際完成考核人數（依生產類別） 接受定期績效考核人數（依生產類別） 接受定期績效考核比例（依生產類別）
		績效考核覆蓋率（依職級）	實際完成考核人數（依職級） 接受定期績效考核人數（依職級） 接受定期績效考核比例（依職級）
		薪資總額	非主管全時員工薪資總額

薪酬福利與職場環境	薪酬	薪資平均數	薪資平均數 非擔任主管職務之全時員工薪資平均數 最高薪酬者與一般員工的年度總薪酬平均數比率
		薪資中位數	薪資中位數 非擔任主管職務之全時員工薪資中位數 最高薪酬者與一般員工的年度總薪酬中位數比率
		調薪	員工薪資成長率 平均調薪幅度 年度薪酬變化比率
		基本薪資比率	基本薪資比率 基層人員標準薪資與台灣法定基本工資比例 基層人員標準薪資與當地最低薪資的比率 新鮮人起薪與法定基本工資比較倍數
	生育相關福利	產假申請狀況	產假申請人數 陪產假申請人數
		育嬰留職停薪	符合育嬰留停資格人數 實際申請育嬰留停人數 當年度應復職人數 當年度申請復職人數 前一年實際復職人數 前一年復職滿一年仍在職人數 申請率 復職率 留任率
		育嬰留職停薪（依性別）	符合育嬰留停資格人數 實際申請育嬰留停人數 當年度應復職人數 當年度申請復職人數 前一年實際復職人數 前一年復職滿一年仍在職人數 申請率 復職率 留任率
		子女福利與教育補助	生育補助金額 育兒補助受惠人數 員工子女教育補助金額 生育禮金 景碩幼兒園補助金額
		托育與哺乳支持	集乳室總數 產後護理及托育特約機構家數
	生育以外福利	員工結婚補助	結婚補助金額 婚喪喜慶補助金額
		員工社團補助	家庭日／大型活動／各類社團活動福利金額 社團活動補助金額 社團補助數量

薪酬福利與職場環境	生育以外福利	退休金	提撥（舊制）及提繳（新制）之退休金費用 公司提撥至勞工保險局退休金專戶薪資 員工參與舊制退休金制度比例 員工參與新制退休金制度比例 舊制退休金提撥占薪資比例 新制退休金提撥占薪資比例
		其他補助	外籍華語認證補助金額 奠儀補助金額 英、日、韓文語言補助金 員工語言補助報名人次 語文學習補助 醫療補助費金額 三節與生日禮券 員工旅遊補助 餐費補助金額 部門聚餐補助金額 公司文化(五一勞動節及尾牙)／社團／休閒活動補助 團體綜合保險補助 新（換）購電動車補助總額 傷病急難救助金福利金額 年資獎勵福利金額
	假期	生育與家庭相關假期給予	產前假 家庭照顧假
		特休假	有薪休假 特休假
	員工活動	社團活動	社團數量 社團成員數量 新成立社團數 運動類社團數量 其他社團數量
		休閒設施與服務	休閒設施與服務使用人次 視障按摩服務人次 按摩室參加人數 健身房數量 健身設備使用人數 閱覽室藏書數量 文康中心使用人數 運動場館及樂活館入場人次
		健康活動	健康促進活動參與人數 健康促進活動執行場次 減重比賽參與人次 減重總公斤數 戒菸活動參與人數 戒煙成功人數 運動會/運動日參與人次 健走活動參與人次 捐血活動參與人數 捐血活動場次
		特定員工活動	家庭日參與人次 藝術季參與人數

			清涼抗暑活動場次 節日活動場次 其他活動場次
職業安全與健康	工時	工時	總工作時數 承攬商總工作時數 非員工總工作時數
		缺勤統計	缺勤率 總缺勤時數
	傷病情形	傷病統計	失能傷害頻率(FR) 失能傷害嚴重率(SR) 綜合傷害指數(FSI) 輕微以上事故件數 職業病病例數 公傷死亡人數 失能傷害平均損失日數 失能傷害數 嚴重職業傷害件數 嚴重職業傷害比率 嚴重職業傷害人數 重大職災發生件數
		職業安全衛生教育訓練	安全衛生教育訓練課程堂數 職業安全衛生訓練人數 職業安全衛生訓練時數 緊急應變演練場次 防災訓練場次 廠內安全訓練場次
		職業安全衛生委員會	職安衛委員會執行次數 資方代表人數 勞方代表人數 勞方代表比例
		工作環境監控	作業環境改善件數 環境缺失並追蹤改善案件數
	健康管理	健康檢查人次/受檢率	健康檢查參與人次 健康檢查參與比例 特殊健檢參與人次
		健康檢查金額	健康檢查預算金額 健康檢查投入費用 一般健檢檢查費用 特殊健檢檢查費用
		臨場醫療服務	臨床醫療服務人次
		健康相關講座與活動	健康促進講座場次 健康促進講座參與人數
		員工心理與關懷服務	關懷員諮詢服務人次 0800 多元求助專線服務總人次 張老師心理諮商服務使用人次 員工協助方案個案輔導人次
		健康風險管理	健檢報告異常追蹤人次 高風險健康個案追蹤與改善完成率
		防疫與疫苗	自費流感疫苗接種人次
		危害告知與宣導教育訓練	危害告知宣導教育訓練場次 承攬商施工安全宣導場次

職業安全與健康	承攬商管理		消防系統教育訓練場次 緊急疏散演練場次
		施工受傷管理	失能傷害頻率(FR) 失能傷害嚴重率(SR) 綜合傷害指數(FSI) 輕微以上事故件數 職業病病例數 公傷死亡人數 失能傷害平均損失日數 失能傷害數 嚴重職業傷害件數 嚴重職業傷害比率 嚴重職業傷害人數 重大職災發生件數
		健康關懷	醫師臨廠服務場次 工區免費健檢場次

附表二、揭露深度分析結果表（一）

子類別	指標總數			深度分數		
		聯電	華泰	台積電	旺宏	台亞
員工人口分布	12	6	7	9	9	9
員工流動	17	10	9	13	6	6
性別平權	4	1	2	3	3	1
少數群體與外籍員工平權措施	2	0	0	1	0	0
人權保障	2	1	2	1	0	0
勞資溝通	4	1	0	2	0	0
員工敬業度	1	1	0	0	0	0
員工訓練	10	8	4	7	4	4
論調歷練	1	0	0	1	0	0
績效考核	4	0	3	1	0	2
薪酬	5	3	2	4	3	3
生育相關福利	5	2	2	2	2	4
生育以外福利	4	1	0	1	0	2
假期	2	0	0	0	0	0
員工活動	4	4	1	3	1	2
工時	2	2	1	2	0	1
傷病情形	1	1	1	1	1	1
職場安全衛生	3	2	2	2	1	2
健康管理	7	4	4	6	4	3
承攬商管理	3	0	1	3	0	0
總分	93	47	41	62	34	40

附表三、揭露深度分析結果表（二）

子類別	指標總數		深度分數			
		華邦電	順德	矽統	南亞科	超豐
員工人口分布	12	9	8	5	8	5
員工流動	17	12	9	0	15	4
性別平權	4	2	1	0	2	1
少數群體與外籍員工平權措施	2	1	0	0	0	0
人權保障	2	1	1	0	1	1
勞資溝通	4	0	3	0	4	0
員工敬業度	1	1	1	0	0	0
員工訓練	10	7	6	0	8	2
論調歷練	1	1	0	0	1	0
績效考核	4	0	0	0	1	3
薪酬	5	5	3	3	4	1
生育相關福利	5	3	2	0	2	2
生育以外福利	4	2	1	0	1	2
假期	2	2	0	0	0	0
員工活動	4	3	1	0	2	0
工時	2	2	0	0	2	2
傷病情形	1	1	1	1	1	1
職場安全衛生	3	2	3	0	3	1
健康管理	7	4	4	0	3	1
承攬商管理	3	1	1	0	2	1
總分	93	59	45	9	60	27

附表四、揭露深度分析結果表（三）

子類別	指標總數	深度分數				
		京元	景碩	京鼎	台勝科	日月光
員工人口分布	12	7	7	8	5	9
員工流動	17	7	7	6	6	7
性別平權	4	1	1	1	1	2
少數群體與外籍員工平權措施	2	1	0	0	0	1
人權保障	2	0	1	0	0	1
勞資溝通	4	2	0	2	0	2
員工敬業度	1	0	0	0	0	1
員工訓練	10	4	5	5	3	5
論調歷練	1	0	0	0	0	0
績效考核	4	1	2	4	1	0
薪酬	5	3	3	1	3	0
生育相關福利	5	1	3	1	2	4
生育以外福利	4	0	3	1	2	0
假期	2	0	0	0	0	0
員工活動	4	4	2	0	0	2
工時	2	1	2	1	2	0
傷病情形	1	1	1	1	1	1
職場安全衛生	3	2	2	1	2	1
健康管理	7	1	4	2	0	3
承攬商管理	3	2	2	2	1	0
總分	93	38	45	37	29	39

附表五、揭露深度分析結果表（四）

子類別	指標總數	深度分數				
		界霖	力成	華東	南茂	宇瞻
員工人口分布	12	7	9	8	8	9
員工流動	17	6	10	6	7	10
性別平權	4	1	3	2	3	1
少數群體與外籍員工平權措施	2	0	1	0	0	0
人權保障	2	1	1	1	1	0
勞資溝通	4	0	2	2	1	3
員工敬業度	1	0	0	1	0	0
員工訓練	10	4	8	3	7	5
論調歷練	1	0	0	0	0	1
績效考核	4	3	4	2	3	0
薪酬	5	3	4	2	3	4
生育相關福利	5	1	4	1	3	2
生育以外福利	4	0	4	0	3	1
假期	2	0	2	0	0	0
員工活動	4	0	2	2	1	4
工時	2	1	2	1	1	1
傷病情形	1	1	1	1	1	1
職場安全衛生	3	2	2	2	2	2
健康管理	7	2	5	3	5	3
承攬商管理	3	0	1	0	0	0
總分	93	32	65	37	49	47

附表六、揭露廣度分析結果表（一）

核心主題 (第一層)	子分類總數	廣度分數				
		聯電	華泰	台積電	旺宏	台亞
人力資源與 人才流動	2	2	2	2	2	2
人權保障與 多元平等	5	4	2	4	1	1
人才培育與 發展	3	1	2	3	1	2
薪酬福利與 職場環境	5	4	3	4	3	4
職業安全與 健康	5	4	5	5	3	4
廣度總分		15	14	18	10	13

附表七、揭露廣度分析結果表（二）

核心主題 (第一層)	子分類總數	廣度分數				
		華邦電	順德	矽統	南亞科	超豐
人力資源與 人才流動	2	2	2	1	2	2
人權保障與 多元平等	5	4	4	0	3	2
人才培育與 發展	3	2	1	0	3	2
薪酬福利與 職場環境	5	5	4	1	4	3
職業安全與 健康	5	5	4	1	5	5
廣度總分		18	15	3	17	14

附表八、揭露廣度分析結果表（三）

核心主題 (第一層)	子分類總數	廣度分數				
		京元	景碩	京鼎	台勝科	日月光
人力資源與 人才流動	2	2	2	2	2	2
人權保障與 多元平等	5	3	2	2	1	5
人才培育與 發展	3	2	2	2	2	1
薪酬福利與 職場環境	5	3	4	3	3	2
職業安全與 健康	5	5	5	5	4	3
廣度總分		15	15	14	12	13

附表九、揭露廣度分析結果表（四）

核心主題 (第一層)	子分類總數	廣度分數				
		界霖	力成	華東	南茂	宇瞻
人力資源與 人才流動	2	2	2	2	2	2
人權保障與 多元平等	5	2	4	4	3	2
人才培育與 發展	3	2	2	2	2	2
薪酬福利與 職場環境	5	2	5	3	4	4
職業安全與 健康	5	4	5	4	4	4
廣度總分		12	18	15	15	14